

COMPUTEX 2025

與亞馬遜共創 產業新生態系

雲端、AI、資安與製造全面融合，重塑產業競爭力

串聯全球資源與在地創新，打造新世代韌性產業鏈

精選議題

2025 COMPUTEX 聚焦三大主題

AI Server供應鏈 / AI PC晶片、ASIC / 智慧運算

- COMPUTEX 2025一席難求 AI伺服器廠齊聚亮相
- AI新勢力上陣COMPUTEX 高通、聯發科挑戰IT老將有成

觀點解析

- AI 資源瓶頸 為 CXL 技術帶來市場轉機 相關軟硬生態系 2025 年有望大放異采
- 10 年一周期 量子電腦以實現計算優越性為目標



從雲端到邊緣

慧榮科技打造 AI 時代的儲存解決方案

苟嘉章表示，隨生成式 AI 蓬勃發展讓相關應用門檻降低，慧榮科技也將以高效能、低功耗的多元儲存解決方案滿足市場需求。

慧榮科技



隨著 2025 年 COMPUTEX 聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」與「未來移動」三大主題，並以「AI Next」為核心，全球科技大廠齊聚一堂，展現 AI 技術實力。AI 應用想像快速落地的同時，也加速了各種應用場景對高效儲存技術的迫切需求。作為全球最大 NAND Flash 控制晶片供應商，慧榮科技正扮演推動 AI 生態關鍵角色。

掌握應用場景儲存需求，從低延遲、低功耗到高吞吐量助攻邊緣 AI 發展

「DeepSeek 的出現大幅降低了 AI 應用門檻，」慧榮科技總經理苟嘉章 (Wallace Kou) 指出。作為開源技術，DeepSeek 降低了語言模型訓練成本，正逐步顛覆產業對 AI 的傳統認知，加速邊緣應用普及。他強調，從智慧型手機、筆電到各式穿戴裝置，AI 導入浪潮已然成形，而支撐這波變革的關鍵，正是儲存技術。

苟嘉章在剖析 AI 儲存架構時指出，AI 應用要在各種場景中實現，從最初的資料擷取 (Ingest)、資料準備 (Preparation)、模型訓練 (Training) 到推理 (Inference)，每一階段對儲存系統都有不同需求。以資料擷取為例，大量資訊匯入需具備高寫入吞吐量；而模型訓練則更重視低延遲表現與多樣化 I/O 大小的支援。儘管需求各異，但整體架構仍須具備高吞吐量、低延遲、低功耗、可擴展性與高可靠性五大核心特性，才能滿足 AI 應用的實際需求。

為因應 AI 應用帶來的龐大資料需求，慧榮科技透過控制晶片技術升級，引領儲存創新。苟嘉章指出，

透過分層管理與智能辨識機制，可有效優化資料應用流程，並導入彈性資料放置 (FDP) 技術，提升寫入效率與耐久性，同時兼具低延遲與低成本的優勢。在資料安全與可靠性方面，產品採用先進的加密標準與防篡改硬體設計，結合端到端資料保護機制與專利 NANDXtend™ 技術，確保資料在整個生命週期中的安全與穩定性。此外，慧榮科技支援 2Tb QLC NAND 及 6/8-Plane NAND，結合智能電源管理 (PMC) 與先進製程工藝，在提升儲存密度的同時，有效降低能耗。

不僅如此，搭載慧榮科技獨有的 PerformaShape 技術，透過多階段架構演算法，根據使用者定義的 QoS 集優化 SSD 效能。FDP 與 PerformaShape 的結合，不僅能有效管理資料、降低延遲，更可顯著提升整體效能約 20-30%，特別適用於多租戶環境下的 AI 資料管道，涵蓋資料擷取、資料準備、模型訓練與推理等關鍵階段。

從雲端到邊緣的 AI 應用，打造全方位解決方案滿足客戶需求

慧榮科技因應資料中心與雲端儲存需求，推出業界首款支援 128TB QLC PCIe Gen5 企業級 SSD 參考設計套件，採用搭載 SM8366 控制晶片的 MonTitan SSD 開發平台，支援 PCIe Gen5 x4、NVMe 2.0 和 OCP 2.5 標準，連續讀取逾 14 GB/s，隨機效能達 330 萬 IOPS，效能提升超過 25%。此設計可加速大型語言模型 (LLM) 與圖神經網路 (GNN) 訓練，同時降低 AI GPU 能耗，滿足高速資料處理需求。

針對邊緣儲存解決方案，苟嘉章指出，具備 AI 能力的終端裝置將快速成長。他表示：「未來 5 至 10 年內，AI 人形機器人市場將迎來爆發。」不同層級的系統對儲存有著差異化需求，例如感知層需即時處理與過濾資料以確保感測準確性，決策層則仰賴多模態融合推理，對儲存效能與資料整合能力提出更高要求；而執行層則需儲存各項校對參數，使機器人更貼近人類的思維與動作邏輯。對此，慧榮已積極布局 NVMe SSD、UFS、eMMC、BGA SSD 等儲存解決方案，並強調跨界合作與生態系共建，以推動智慧終端儲存技術演進。

此外，慧榮推出多款高效能、低功耗的控制晶片以滿足終端裝置的 AI 應用需求：SM2508 PCIe Gen5 控制晶片針對 AI 筆電與遊戲機設計，功耗較同級產品降低達 50%；SM2324 支援高達 16TB 的 USB 4.0 高速可攜式儲存裝置；而 SM2756 UFS 4.1 控制晶片功耗效率較 UFS 3.1 提升 65%，為 AI 手機提供優異的儲存體驗。面對自駕車對高速與大容量儲存的迫切需求，慧榮也攜手全球 NAND 大廠與模組廠，共同打造智慧車用儲存解決方案。

「儲存技術無疑是 AI 生態系中的核心環節，」苟嘉章強調，台灣擁有完整且高度整合的半導體與資通訊產業鏈，不僅具備打造 AI 伺服器的能力，更擁有推動 AI 應用發展的深厚潛力。他相信，未來將有更多實用的 AI 邊緣裝置與創新應用加速問世，並對儲存解決方案提出更嚴苛的要求，以因應海量資料處理所帶來的挑戰。慧榮科技也將持續以技術創新為動能，積極助力 AI 發展。

掌握應用場景儲存需求，從低延遲、低功耗到高吞吐量助攻邊緣 AI 發展

「DeepSeek 的出現大幅降低了 AI 應用門檻，」慧榮科技總經理苟嘉章 (Wallace Kou) 指出。作為開源技術，DeepSeek 降低了語言模型訓練成本，正逐步顛覆產業對 AI 的傳統認知，加速邊緣應用普及。他強調，從智慧型手機、筆電到各式穿戴裝置，AI 導入浪潮已然成形，而支撐這波變革的關鍵，正是儲存技術。

苟嘉章在剖析 AI 儲存架構時指出，AI 應用要在各種場景中實現，從最初的資料擷取 (Ingest)、資料準備 (Preparation)、模型訓練 (Training) 到推理 (Inference)，每一階段對儲存系統都有不同需求。以資料擷取為例，大量資訊匯入需具備高寫入吞吐量；而模型訓練則更重視低延遲表現與多樣化 I/O 大小的支援。儘管需求各異，但整體架構仍須具備高吞吐量、低延遲、低功耗、可擴展性與高可靠性五大核心特性，才能滿足 AI 應用的實際需求。

為因應 AI 應用帶來的龐大資料需求，慧榮科技透過控制晶片技術升級，引領儲存創新。苟嘉章指出，

透過分層管理與智能辨識機制，可有效優化資料應用流程，並導入彈性資料放置 (FDP) 技術，提升寫入效率與耐久性，同時兼具低延遲與低成本的優勢。在資料安全與可靠性方面，產品採用先進的加密標準與防篡改硬體設計，結合端到端資料保護機制與專利 NANDXtend™ 技術，確保資料在整個生命週期中的安全與穩定性。此外，慧榮科技支援 2Tb QLC NAND 及 6/8-Plane NAND，結合智能電源管理 (PMC) 與先進製程工藝，在提升儲存密度的同時，有效降低能耗。

不僅如此，搭載慧榮科技獨有的 PerformaShape 技術，透過多階段架構演算法，根據使用者定義的 QoS 集優化 SSD 效能。FDP 與 PerformaShape 的結合，不僅能有效管理資料、降低延遲，更可顯著提升整體效能約 20-30%，特別適用於多租戶環境下的 AI 資料管道，涵蓋資料擷取、資料準備、模型訓練與推理等關鍵階段。

從雲端到邊緣的 AI 應用，打造全方位解決方案滿足客戶需求

慧榮科技因應資料中心與雲端儲存需求，推出業界首款支援 128TB QLC PCIe Gen5 企業級 SSD 參考設計套件，採用搭載 SM8366 控制晶片的 MonTitan SSD 開發平台，支援 PCIe Gen5 x4、NVMe 2.0 和 OCP 2.5 標準，連續讀取逾 14 GB/s，隨機效能達 330 萬 IOPS，效能提升超過 25%。此設計可加速大型語言模型 (LLM) 與圖神經網路 (GNN) 訓練，同時降低 AI GPU 能耗，滿足高速資料處理需求。

針對邊緣儲存解決方案，苟嘉章指出，具備 AI 能力的終端裝置將快速成長。他表示：「未來 5 至 10 年內，AI 人形機器人市場將迎來爆發。」不同層級的系統對儲存有著差異化需求，例如感知層需即時處理與過濾資料以確保感測準確性，決策層則仰賴多模態融合推理，對儲存效能與資料整合能力提出更高要求；而執行層則需儲存各項校對參數，使機器人更貼近人類的思維與動作邏輯。對此，慧榮已積極布局 NVMe SSD、UFS、eMMC、BGA SSD 等儲存解決方案，並強調跨界合作與生態系共建，以推動智慧終端儲存技術演進。

此外，慧榮推出多款高效能、低功耗的控制晶片以滿足終端裝置的 AI 應用需求：SM2508 PCIe Gen5 控制晶片針對 AI 筆電與遊戲機設計，功耗較同級產品降低達 50%；SM2324 支援高達 16TB 的 USB 4.0 高速可攜式儲存裝置；而 SM2756 UFS 4.1 控制晶片功耗效率較 UFS 3.1 提升 65%，為 AI 手機提供優異的儲存體驗。面對自駕車對高速與大容量儲存的迫切需求，慧榮也攜手全球 NAND 大廠與模組廠，共同打造智慧車用儲存解決方案。

「儲存技術無疑是 AI 生態系中的核心環節，」苟嘉章強調，台灣擁有完整且高度整合的半導體與資訊產業鏈，不僅具備打造 AI 伺服器的能力，更擁有推動 AI 應用發展的深厚潛力。他相信，未來將有更多實用的 AI 邊緣裝置與創新應用加速問世，並對儲存解決方案提出更嚴苛的要求，以因應海量資料處理所帶來的挑戰。慧榮科技也將持續以技術創新為動能，積極助力 AI 發展。

封面故事

與亞馬遜共創產業新生態系

- 供應鏈變革下重塑製造新競局 AWS在台設區域資料中心挺產業升級 20
- 趨勢科技攜手AWS 實現 AI for Security、Security for AI營運願景 22

精選議題

2025COMPUTEX 聚焦三大主題
AI Server供應鏈／AI PC晶片、ASIC／智慧運算 03

- COMPUTEX 2025一席難求 AI伺服器廠齊聚亮相 04
- AI新勢力上陣COMPUTEX 高通、聯發科挑戰IT老將有成 06

觀點解析

- AI資源瓶頸為CXL技術帶來市場轉機 相關軟硬生態系 2025年有望大放異采 24
- 10年一周期 量子電腦以實現計算優越性為目標 42

品牌聚焦

- 從雲端到邊緣 慧榮科技打造AI時代的儲存解決方案 01
- 以新一代LPU催生多樣化AI代理 Skymizer助力構築智慧未來世界 10
- 宜鼎聚焦Architect Intelligence全面布局 COMPUTEX 2025展出企業AI化與邊緣運算關鍵方案 14
- 聚焦多元化產業並進與一站購足機制 明緯同步滿足AI與ESG需求 18
- 前進COMPUTEX施耐德電機重磅展示 AI-Ready資料中心冷卻與設計能量 30
- 打造設計與量產的橋梁 Lynwave「ATM整合方案」引領無線通訊高頻世代 34
- PEGATRON強化AI伺服器到終端產品布局 深耕AI應用大戰略 38
- BIOSTAR映泰推出EdgeComp系列MS-X6413E與MS-N97工業電腦 強化自動化與邊緣運算佈局 40
- 智微科技偕同開酷科技於COMPUTEX 展示最新RAID存儲解決方案與人工智慧感測技術 41
- 廣和通AI能力與產品升級 助智慧硬體企業熱烈擁抱AI 48
- DEEPX 50

焦點廠商 52

2025 COMPUTEX

聚焦
三大主題

AI Server供應鏈 ➤

AI PC晶片、ASIC ➤

智慧運算 ➤



COMPUTEX 2025一席難求 AI伺服器廠齊聚亮相



鴻海在 NVIDIA GTC 大會上，展示與 NVIDIA 合作最新 GB300 NVL72 伺服器機櫃純液冷版本，其每層 Compute Tray 將配置 9~12 個水冷板。 鴻海

NVIDIA 據悉將擴大參與 COMPUTEX 2025

預計設置多達 60 個攤位

為近年來規模最大的一次展出

屆時，NVIDIA 也將聯手鴻海等多家生態系夥伴

共同展示「NVIDIA GB300 NVL72」系統與相關解方

COMPUTEX 2025 登場，AI 伺服器仍是眾所矚目的焦點。鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、技嘉、華碩都將展出最新的伺服器產品，而在2024年引領風騷的GB200機櫃，此次將可見到各家推出「GB300」機櫃與相關解決方案。

DIGITIMES Research 估計，2024 年台廠伺服器相關事業營收大幅成長 63%，優於出貨量表現，AI 伺服器的單價較高，預期 2025 年，大型語言模型（LLM）應用將開始大量落地，商用型 GPU 與雲端業者自研 AI ASIC 伺服器需求仍將大幅成長，台廠營收將成長超過 5 成。

COMPUTEX 2025 是 AI 伺服器供應鏈展示武力的最佳舞台，主因是全球 AI 伺服器有 9 成出自於台灣 EMS/ODM 廠，即便地緣政治及關稅等議題，持續在市場上衍生出程度不同的風波，AI 產業的發展，也依舊是多數業者看重的趨勢。

本屆 COMPUTEX 的焦點，除了依舊聚焦於支撐 AI 產業發展的 AI 伺服器之外，隨著產品技術的逐漸成熟與新世代 B300 系列即將於 2025 年下半年推出，AI 伺服器及其供應鏈亦成為與會業者最感興趣的部分。

包括鴻海、廣達、緯穎、英業達等多家 AI 伺服器供應鏈業者，除了在現場展出已陸續進入放量生產的 GB200 系列外，針對 B300 系列，各家業者也分別展出了不同的解決方案，包括 HGX、MGX 及 GB300 機櫃，都會是重點。

特別是針對新世代 AI 伺服器與 AI 資料中心將會面臨的高功耗問題，相關業者也分別針對 AI 資料中心需求提出不同解決方案，也希望透過產業間的交流共同探討如何打造高效能、低功耗的資料中心架構。

NVIDIA 於先前的 GTC 2025 展會上，對外展示了所謂 MGX 系列產品的產業生態供應鏈，在獲得 NVIDIA 加持之後，從水冷快接頭、電源線束、冷板、電源供應器到機櫃，甚至整機，將會有更全面而完整的產業供應鏈出現在 COMPUTEX 展場上。



此外，有多家散熱、電源等機構件廠，也將現身 COMPUTEX，展出各項新品，包括機殼廠勤誠、晟銘電；散熱模組廠雙鴻、力致、高力；電源廠台達電、光寶都將共襄盛舉。

且據說，此屆 COMPUTEX 展出攤位一位難求，可見熱門程度。

除了 NVIDIA 創辦人黃仁勳將有主題演講外，鴻海董事長劉揚偉也首度登上展會舞台做專題演講，分享鴻海在推動集團轉型的智慧製造、智慧電動車及智慧城市等三大智慧平台的產業應用願景，以及機器人在未來工廠中所扮演的角色。

由於 COMPUTEX 2025 以圍繞 AI 科技產業應用及解決方案為主，因此各家業者除了展示在 AI 伺服器供應鏈中的實力外，其他像 AI 相關服務應用技術、包括無人機在內的各式機器人產品與應用等，也都將是在系統及解決方案之外，各家大老展示的重點。





AI新勢力上陣COMPUTEX

高通、聯發科
挑戰IT老將有成

高通與聯發科執行長將再度現身 COMPUTEX

若聯發科在展期推出自己的 AI PC 平台

屆時兩大廠間的正面交鋒，勢必將成為焦點戲碼

COMPUTEX 2025 將在5月20日於台北登場，這次的主題演講除了幾乎成為固定嘉賓的NVIDIA 執行長黃仁勳確定會出席外，在2024年難得現身的英特爾（Intel）和超微（AMD）執行長本次皆不會到場，因此讓高通（Qualcomm）與聯發科執行長演說日程被大幅提前，成為這次最受關注的講者群。

高通與聯發科這兩家過去在手機市場激烈廝殺的老對手，如今似乎成為COMPUTEX 新一代的扛壩子，這個變化雖然令人略感意外，但這確實也是兩家公司挑戰傳統 IT 晶片強權有成的證明。

高通的 AI PC 晶片產品線已推出市場一段時間，雖然仍面對到 WoA 生態系不夠完整，以及新進晶片品牌市場能見度較低等挑戰，但高通認為，其在短時間之內已經在幾個重點市場達到不錯的 PC 滲透率，以一個在 PC 市場耕耘不久的業者來說，算是不錯的成果。

高通對未來發展更是樂觀看待，目前公司在不同規格與價格帶推出多種不同選擇的戰略，對於公司加速擴大 AI PC 概念及品牌形象來說，都有正面的幫助。

外界普遍預估，2025 年高通執行長 Cristiano Amon 來台不一定會針對 AI PC 晶片平台有更多新的發表，但有機會看



高通執行長

Cristiano Amon

到一些 AI PC 新應用介紹，或者是和台灣生態系更進一步的合作。

此外，高通先前也曾提到，台灣除了 PC 生態系之外，工控應用生態也是高通非常著重的一環。

隨著 AI 在邊緣端百花齊放的趨勢愈來愈明確，這次的主題演講也有機會看到高通進一步宣傳和台灣工控合作夥伴針對 AI 的相關發展。

至於聯發科方面，既有的雲端 ASIC 應用勢必會是宣傳的重點之一，這也是聯發科和高通在策略上有所分歧的一個領域，近期和 NVIDIA 在 ASIC 領域有進一步的合作，這點有望讓聯發科在雲端

ASIC 有更進一步的發展。

不過，外界普遍並不認為



聯發科執行長

蔡力行

聯發科在 ASIC 業務上，會有更進一步的新消息可以透露，主要還是針對既有的技術能力與合作夥伴進行宣傳，畢竟這塊市場當中，絕大多數的客戶還是希望能夠儘可能保持低調。

聯發科是否會在這一次主題演講期間推出自己的 AI PC 平台，才是外界最期待的重點，由於聯發科稍早已經宣布推出最新的旗艦 Chromebook 晶片平台，並且具備 50 TOPS 的 AI 算力，這被視為是接下來推出 AI PC 晶片的起手式。

從可見的技術實力來看，聯發科絕對有能力在硬體上打造出具備足夠競爭力的 AI PC 晶片，若如外界傳言，內部搭載的是 NVIDIA 的 GPU，在宣傳上又能夠增添一個新話題，有望讓整個 AI PC 市場變得更加熱鬧。

當然，這意味著高通和聯發科在 AI PC 領域即將再次變成正面競爭的關係，不過業界人士對於這個狀況其實也是樂見其成，畢竟整個 PC 晶片領域已經僵固許久，高通和聯發科這兩個新勢力在這塊市場取得豐碩成果，帶來更激烈競爭的同時，其實也會帶來更多新的設計想法，這對於整個 PC 生態系和消費者來說，絕對是正向的發展。



高通專為 AI PC 設計 Snapdragon X Elite 處理器

加速 AI 應用儲存創新

慧榮科技 (NasdaqGS: SIMO) 是全球領先的 NAND 快閃記憶體控制晶片供應商，從雲端到邊緣提供完整的儲存解決方案，產品廣泛應用於 AI PC、AI 智慧型手機、遊戲主機、PC 擴充基座，以及資料中心與企業級儲存、工控與車用等領域。慧榮科技以領先的技術驅動次世代創新，滿足 AI 時代智慧裝置對高效能、低功耗與高可靠性儲存的迫切需求。

歡迎在 COMPUTEX 現場體驗我們的最新技術亮點：

- SM2504XT 與 SM2508 PCIe Gen5 Client SSD 控制晶片
- SM2324 USB4 可攜式 SSD 控制晶片
- MonTitan® PCIe Gen5 企業級 SSD 開發平台



攤位號碼：G0001 (台北南港展覽館一館 3F)

採限邀制，請聯絡我們的業務代表或掃描 QR-Code 申請。



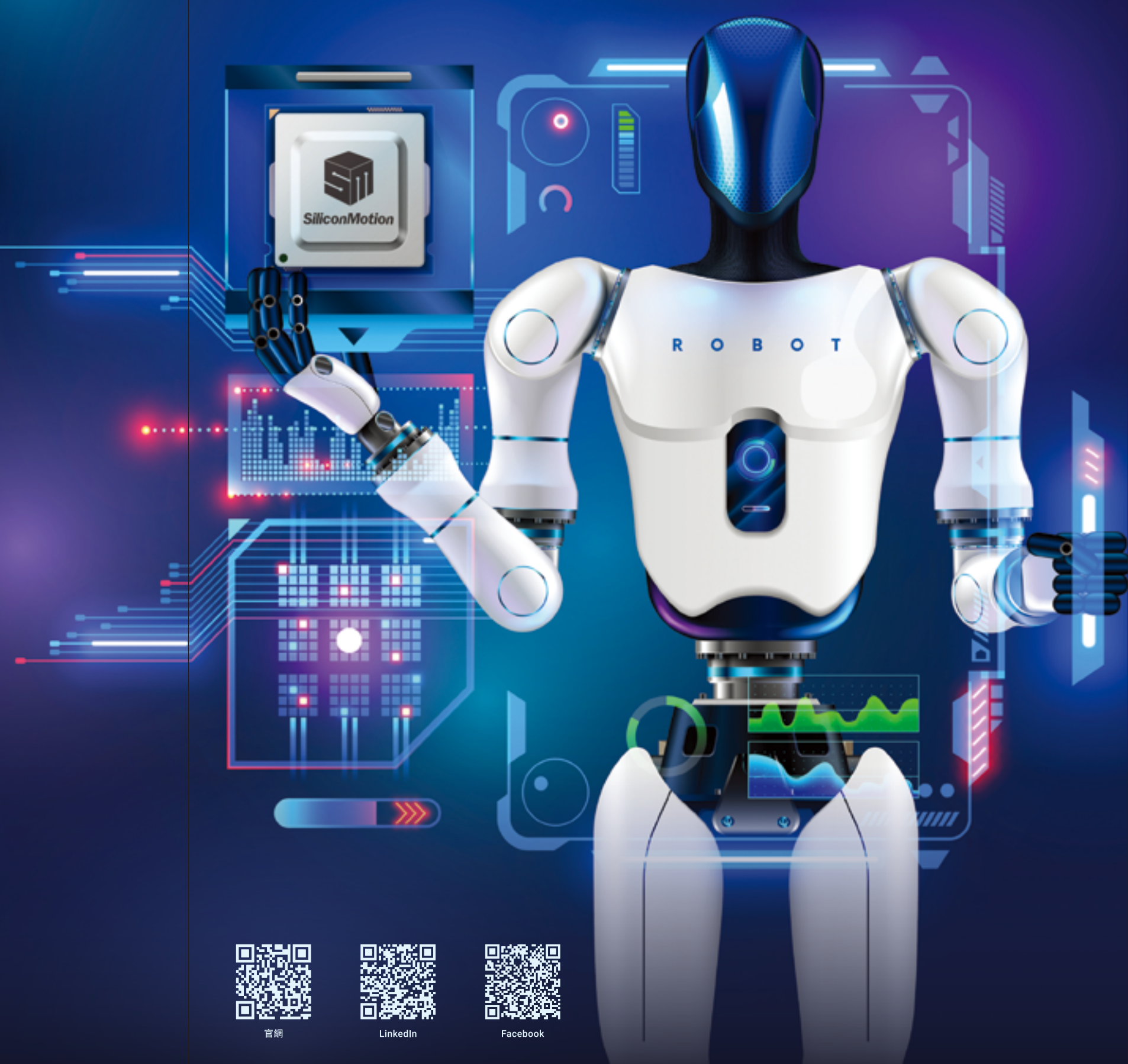
官網



LinkedIn



Facebook



以新一代 LPU 催生多樣化 AI 代理 Skymizer 助力構築智慧未來世界



HyperThought -
Skymizer next
generation LPU

Skymizer 行銷長暨執行
副總經理 魏國章

想像一下在忙碌的工廠生產線上，人類領班正指揮機器人作業員有條不紊地進行電子產品組裝與測試等任務，彼此合作無間、取長補短，讓工作效率與品質大幅提升；還有機器人管家能 24 小時全年無休地貼身照顧行動不便的獨居銀髮長者，確保他們的安穩生活與身心健康；而在交通繁忙的上下班通勤路途中，聰明幽默、會相互溝通的「夥計」（也許你還記得 1980 年代最紅的電視影集《霹靂遊俠》(Knight Rider)）載著乘客們平安順暢抵達目的地，還能幫忙預約想去的餐廳！

以上這些我們以為在科幻電影或小說裡才會出現的場景，即將在不遠的未來於日常生活周遭發生——隨著生成式 AI 技術持續演進，被導入各種邊緣裝置實現智慧功能，且朝著整合影像、語音、文字等不同資料的多模態 (multimodality) 形式，以及更具自主能力、可即時互動的代理式人工智慧 (Agentic AI) 等方向發展，一旦相關硬體解決方案更成熟、更容易取得與使用，就會看到大型語言模型 (LLM) 推論應用的大爆發。

看準這波邊緣 AI 商機，以編譯器軟體起家、目前專注提供 AI 晶片加速器 IP 的市場新秀臺灣發展軟體科技 (Skymizer)，繼在 2024 年台北國際電腦展 (Computex Taipei) 期間正式發表名為 EdgeThought 的語言處理單元 (Language Processing Unit, LPU) 之後，將於 2025 年度 Computex 推出功能更強大的新一代 LPU —— HyperThought，期望能協助開發者輕鬆、迅速針對特定 AI 應用打造專屬 IC，扮演構築智慧未來世界的關鍵力量。

在初代 LPU 基礎上再進化

Skymizer 行銷長暨執行副總經理魏國章表示，與第一代 LPU EdgeThought 相比較，HyperThought 的最大進展就是對多模態 AI、模型並行執行 (Concurrent) 以及代理式 AI 應用的支援；他解釋：「這類應用整合語音、文字與影像等不同類型的資料輸入與輸出，需要更複雜的運算，HyperThought 支援我們自主開發的最新 3.0 版本語言指令集架構 (Language Instruction Set Architecture, 簡稱 LISA)，能大幅提升 LLM 推論專用晶片的運算效率與功耗表現，同時助力廠商降低在邊緣端裝置上開發 AI 代理等新興應用的複雜度與成本。」2025 年 HyperThought 系列 LPU 以 Skymizer 獨家編譯器技術為核心，可將硬體利用率和效率最大化，在最小的晶片面積上實現高達 95% 的 MAC 利用率，因此即使在資源有限的邊緣裝置，亦能實現優異的 AI 推

論任務執行效能。透過先進的混合精度量化技術，該 LPU 能有效縮小模型權重、減少記憶體資源佔用，同時維持一定的準確度。除了不必採用最先進半導體製程節點生產而帶來的成本競爭力，HyperThought 也具備可擴展彈性，能因應從消費性電子、物聯網 (IoT) 裝置、手機、PC、汽車到邊緣伺服器等多樣化硬體設計需求，致力於扮演生成式 AI 應用普及化的重要推手。以半導體晶片約 18 到 24 個月的開發週期來看，最快今年底前就可以看到內含 HyperThought 的 ASIC 或智慧產品問世，讓終端使用者親自體驗邊緣 AI 的威力。奠基於第一代 LPU 的成功，將在 2025 年 Computex 期間亮相的 HyperThought 聚焦更具發展潛力的 AI 代理應用，準備好迎接新一波的 AI 革命。

聚焦更具自主能力的 AI 代理

AI 代理就是更具自主能力的智慧助理，能根據使用者的目標與習慣，主動分析、決策並執行多步驟任務；魏國章指出，AI 代理形容就像是功能更進階的 Apple Siri，它們不僅是能理解人類的語意、以自然語言回應，還能自主在後端處理被交辦的事項並直接提供成果，而非只是開啟一個個 APP。AI 代理可扮演溝通能力與互動性更強的客服，化身秘書協助規劃行程並預訂機票、酒店等任務，或是代替人類進駐險惡的工作環境（如森林大火災區），依據現場情況即時決策，執行設備控制、因應緊急情況等等動作；還有就像《霹靂遊俠》影集中男主角李麥克的那輛智慧車「夥計」，除了會自動駕駛，還能協助主人完成各種任務。這些複雜的 AI 代理任務對運算資源與即時回應能力有極高要求，以往得仰賴雲端平台來執行，

隨著使用者對隱私機密資料的重視，以及部分應用對低延遲的特別要求、或是部署地點連網不易等考量，再加上由 DeepSeek 掀起的 AI 大模型「蒸餾」熱潮，預期未來會有越來越多案例部署於邊緣端，而 HyperThought 正是為此趨勢而生。魏國章強調，Skymizer 是業界少數具備指令集架構開發能力的公司之一，不僅 LPU 能彈性支援包括 Arm、RISC-V 等各種 CPU 架構，適應不同算力規模的設計，還能提供各種應用所需的軟體堆疊，讓 AI 代理可以更流暢地在手機、PC、車載系統甚至嵌入式裝置中運作。隨著生成式 AI 加速演進，Skymizer 將與產業生態系夥伴以及開發者社群緊密合作，讓 LPU 成為推動 AI 從「工具」變成各行各業與人們日常生活不可或缺之「助手」或「夥伴」角色的核心技術。

KIOXIA

鎧俠 驚豔新篇

引領全方位快閃記憶體與SSD創新
南港展覽館2館3樓 X0001



The Defining Piece That Powers AI

ZEISS



■ 展覽日期 | 2025 年5月20日 (週二) 至5月23日 (週五)
■ 展出地點 | 台北南港展覽館一館 | 攤位編號 I0318



預約參觀制

宜鼎聚焦 Architect Intelligence 全面布局 COMPUTEX 2025 展出企業 AI 化與邊緣運算關鍵方案

宜鼎於 COMPUTEX 凸顯「企業 AI 化加速器」定位，展出結合軟硬體與服務，並涵蓋 AI 模型部署、數據管理、應用落地的一站式解決方案。圖為宜鼎國際智能周邊應用事業處處長 吳志清



生成式 AI 帶動數位轉型新浪潮，全球正加速邁向企業 AI 化進程。在今年的 COMPUTEX 展會上，宜鼎國際以「Architect Intelligence」為核心主題，完整呈現從元件、運算平台到一站式應用的 AI 全面布局，由創立之初的儲存裝置供應商，成功轉型為企業邊緣 AI 化的最佳夥伴。

宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清指出，回顧過去幾年，AI 技術歷經爆發性的成長，從 ChatGPT、圖像生成等單點生成式模型應用，逐步進化至產業實際營運所需的決策支援與流程自動化。於本次 COMPUTEX，宜鼎展出一系列 AI 解決方案，以實際案例將產業對 AI 應用的期待化為現實，全力促進「產業 AI 化」。

過往 AI 部署多集中在雲端與大型資料中心，導入成本高、部署流程複雜，讓許多中小企業望而卻步。然而，隨著 DeepSeek 等開源模型問世，結合模型蒸餾、MOE (Mixture of Experts) 等輕量化技術，AI 導入門檻也隨之大幅降低，更有助於增加企業 AI 化的可行性與普及速度。吳志清表示，這波轉變帶來的不僅是技術上的革新，更是思維上的改變——市場不再只追求生成式 AI 的單點能力，而是開始思考，如何將這些能力系統性地整合進企業營運流程中，從資料蒐集、分析到決策反饋，形成以 AI 驅動的完整營運模式。

Architect Intelligence 架構 從硬體到應用的一站式方案

呼應市場需求，宜鼎於 COMPUTEX 2025 展出硬體、軟體、服務三位一體的 AI 解決方案，詮釋在集團「Architect Intelligence」策略下的全新角色定位。

硬體方面，宜鼎展出多款新世代 AI 運算與儲存設備，包括支援不同 AI 算力的邊緣 AI 平台、可針對 AI 推論過程進行讀寫最佳化的 AI SSD、支援企業級應用的資料中心 SSD、以及針對遠距醫療、LLM 與數位孿生等應用情境而生的 DDR5 MRDIMM、CXL 等 AI 記憶體解決方案。此外，現場也同步展出多模態影像解決方案，相機模組產品涵蓋 USB、MIPI 與 GMSL 等介面，扮演邊緣裝置的「眼睛」，透過視覺感測為 AMR、AGV、重型機械施作等場景開啟更多應用可能性。

在軟體部分，宜鼎則推出多項 No-code 工具，包括支援 RAG (檢索增強) 的 AccelBrain 與 Fine-tune 應用的 AccelTune，協助企業以低門檻、低成本方式導入 AI 技術，並快速完成 POC 驗證。透過集中化設備管理平台 iCAP，企業亦能簡化邊緣裝置部署與維運流程。此外，承襲公司成立以來提供「極致服務」的精神，宜鼎在 Architect Intelligence 策略中亦重視服務面的延伸。為此，宜鼎建構了完善的夥伴生態系，讓旗下解決方案除了具備與各家主流硬體平台的相容性外，搭載的第三方 ISV 軟體也皆需通過相容性驗證，確保系統穩定性。而針對不同產業應用需求，宜鼎除了可提供自主研發的軟硬體，更可彈性串接豐富的第三方夥伴資源與服務，協助客戶堆疊、整合出最適合的全方位解決方案，進一步降低導入門檻與整合成本。

滿足產業需求推動 AI 應用落地

吳志清提到，隨著 AI 技術商用化進程加速，多數企業在部署 AI 應用時，仍普遍面臨人才缺乏、導入成本高昂與系統整合困難等挑戰。特別是中小型企业，常因技術門檻與預算限制，往往難以實現數位轉型與 AI 導入。

為解決痛點，宜鼎在 Architect Intelligence 架構中設計了全方位的導入解方。透過 No-code 訓練與推論平台與軟硬整合服務，企業客戶最快僅需一個月，即可完成 AI POC 驗證，並投入實際營運。

宜鼎也在本次會場中展示 AI 於智慧製造、智慧醫療及智慧交通等場域的實際應用案例。吳志清指出，例如近年製造業勞動力短缺，宜鼎透過 AI 優化產品檢測流程，協助工廠降低基礎人力需求、提升生產效率；在醫療場域及公共場所，則可結合相機、空氣感測器等擴充模組加以監測人流及空氣品質，提升就醫體驗及管理效率，並透過具備 AI 算力的設備，輔助醫生進行精準的決策及遠端診療。

深化技術佈局，持續鞏固領先優勢

面對未來 AI 應用浪潮，吳志清表示，宜鼎將以「想像力、產品力、技術力」為三大核心競爭優勢。

首先，在「想像力」方面，宜鼎跳脫傳統硬體產品思維，積極從客戶應用需求出發，重新定義產品設計與應用模式，致力於創造更具市場價值的解決方案。

「產品力」部分，宜鼎強調場域導向與實用性。透過與客戶密切溝通，深入理解各產業場域需求，緊密結合硬體元件設計與實際應用情境，從硬體裝置與儲存行為優化，到邊緣設備的遠端管理，均體現公司以使用者需求為核心的產品開發理念。在「技術力」層面，宜鼎國際持續投入技術研發與平台優化，整合旗下產品事業單位與集團子公司的資源，構築涵蓋 AI 時代所需的感測、儲存、運算與應用等完整技術體系。

吳志清強調，宜鼎採取「Top-down」思維，從應用場景與客戶需求出發，反推產品架構與規格設計，確保每一項產品與服務皆真正貼近市場需求。

從儲存元件到企業 AI 化推手，宜鼎全面進化

隨著 AI 時代到來，宜鼎國際將以企業 AI 化加速器角色，搭配 Architect Intelligence 策略，提供結合硬體、軟體、服務，與涵蓋 AI 模型部署、數據管理、應用落地的一站式解決方案。未來，宜鼎國際將持續攜手全

球夥伴，深化邊緣 AI 生態系建構，讓 AI 技術真正走進各行各業的營運日常，成為企業邁向智能未來的重要推手。



Proactive Security
Starts Here



🕒 2025.05/20 ~ 05/23

📍 N0114, TaiNEX1



**SECURE
AI NEXT**

Demo Pod



Security for
AI Blueprint



Inside the Mind
of the Adversary



Secure Your
AI Factory

Lightning Session

Imagine with AI : Your Blueprint for a Secure AI Future

Proactive Strategies to Secure Your AI Data and Models

Securing the AI Stack : Microservices, Infrastructure &
Network Defense

Securing the Human Element : Managing AI Access and
User Interaction Risk

Outsmarting the Enemy : Leveraging Your Digital Twin for
Real-Time Attack Simulation

Sovereign by Design : Compliant Innovation with Full Control

Scan and Win!

Have your badge scanned by our booth staff and
receive a complimentary box of Elliot's ice cream!



聚焦多元化產業並進與一站購足機制 明緯同步滿足 AI 與 ESG 需求



歡迎參觀明緯
線上展覽館



AI 運算與 ESG 能源轉型趨勢，導致市場對高效能、小型化電源解決方案的需求日益迫切。在今年 COMPUTEX 2025 中，明緯展出的小體積、高效能產品，搭配「多產業並進 × One-Stop-Shopping 一站式購足」策略，將可完整滿足市場對 AI 與 ESG 的電力供應需求。

深耕電源產業逾 40 年的明緯，在 COMPUTEX 2025 展覽現場將展出多款標準電源產品家族解決方案，並與明緯官網線上展覽館即時導覽功能搭配，提供客戶從電源選型、系統實裝到安規驗證的一站式體驗，體現「全方位一站式整合」的服務體驗。

其中包括工業應用的 XDR/XTR 導軌型電源系列（75W~960W），此系列採用先進串聯諧振高效電路設計，效率達到 96%，同時體積大幅縮減 16%~45%，為空間受限的設備提供更靈活靈活的安裝選擇。

另一焦點為 LOP 基板型電源系列（200W~600W），此系列最大特色是同時通過資訊、醫療、家電及工業四大類別安規認證，具提升系統整合效率與產品信賴性，並加速客戶產品認證流程，可縮短開發者終端產品上市時間。

明緯也將同步展示適配器家族 NGE 系列，此系列涵蓋 12W~90W 完整瓦數，並支援多國插頭規格，可在 -30°C ~ +70°C 的嚴苛環境下穩定運作。NGE100 系列是明緯首款導入消費級市場的行動快充，支援最新 USB PD 3.1 協議且採用環保全紙質包裝，充分展現了新品開發融入了 ESG 企業精神。

因應全球能源轉型趨勢與災防備援需求上升，明緯特別展出 NTN-5K 離網型工業級逆變器，此款產品整合 AC-DC 充電與 DC-AC 逆變功能，單機即可提供 5KW 穩定輸出，並支援多台設備並聯擴充至 30KW 及三相供電架構，搭配 MPPT 太陽能充電控制器可實現完整的離網供電系統。

明緯多款新產品均強調小型化、高效化與多領域安規設計，可協助降低系統碳足跡並實現更彈性的電力調配管理，滿足企業的 ESG 與能源韌性雙重需求。從標準電源產品到整合型儲能解決方案，明緯以「多產業並進 × One-Stop-Shopping 一站式購足」的家族化多元產品與應用解決方案策略，佈局在多領域應用，將 ESG 與高效能概念深植於產品細節中，從而展現自身永續發展承諾、協助全球客戶在高效能與實踐永續目標之間取得平衡，為新世代電力建構穩固基礎。



5KW 離網型工業級



NTN-5K 系列

二合一充電器 + 逆變器

- 多功能一體機
(AC-DC充電器 + DC-AC逆變供載 + AC旁路供載)
- 內建AC-DC高功率充電器達4520W
- DC-AC純正弦波輸出 (THD<3%)
- AC輸出瞬間峰值功率可達10KW
- AC輸出可並聯6台，可彈性擴充瓦數高達30KW (5+1 台)
- 使用3台NTN-5K單向AC輸出，可組成3Ø4W使用
- -30 ~ +70°C 超寬溫，適用全球各地或安裝於密閉環境
- 可另購智能控制器：
CMU2E (單機獨立式立放 / 掛軌安裝) 或
CMU2E-R (Rack系統機架式安裝)

- 內建遠端ON/OFF遙控
- 內建MODBus或CANBus通訊監控
- 保護功能：
DC輸入側：極性反接、低壓告警與關機、過壓、
電池過放電保護
AC輸出側：短路、過載、過溫
- 尺寸(長x寬x高)：460 x 211 x 83.5mm
- PCB塗層，具基本防潮、防塵、防汙
- 安規認證：CB / TUV / RCM / EAC / CE / UKCA / FCC
- 可搭配鉛酸或鋰電池使用
- 5 年保固



規格書

📍 南港展覽1館1樓

攤位號碼 K0515a



Contact us



線上展覽館



Facebook



LinkedIn

供應鏈變革下重塑製造新競局 AWS 在台設區域資料中心挺產業升級



隨著全球供應鏈重組與製造模式變革，小量多樣化客製化成為主流製造模式之一。DIGITIMES 社長黃欽勇與 Amazon Web Services (AWS) 台灣暨香港總經理王定愷日前於「科技行腳」節目中，共同深入探討台灣企業對此趨勢的應對之道，與 AWS 在台灣設立區域 (Region) 資料中心的戰略意義。

關稅壓力下的伺服器地緣布局 台灣角色不可或缺

黃欽勇指出，川普關稅政策對台灣科技業成為焦點議題。2024 年美國進口伺服器達 619 億美金，其中超過九成伺服器實質來自台灣，台灣對美貿易順差攀升，導致美國課徵 32% 關稅，引發產業憂慮。儘管短期難達平衡，但台灣在 AI 伺服器領域具不可替代性，因此關稅實際影響的是美國科技巨擘，他們可能與政府協調，台灣毋須過度擔憂，他建議台灣應善用資金投資未來產業，強化國內應用市場，台灣向來製造強應用弱，而 AWS 在台投資區域資料中心，將為台灣產業發展帶來重大契機。

王定愷也表示，AWS 選擇宣布在台灣投資設立 AWS 亞太 (台北) 區域，展現出對台灣產業生態系統的長期承諾與信心。王定愷表示，AWS 新設立的區域資料中心採用領先業界的三可用區域 (3AZ) 架構，確保服務達到最高不中斷標準，全年平均斷線時間為全球最低，提供頂級可用性 (Availability) 效能，高規格設計使客戶在資安、資料保護及延遲性等應用方面均能享有高標準的服務品質。

雲端驅動製造升級 IT 架構強化產業效能

黃欽勇接著提到，台灣製造業近年經歷重大轉型，台商回流挹注逾千億美金投資，製造業 GDP 佔比已在 2024 年躍升至 38%，去年台灣出口達 4751 億美金，電子產品貢獻 65.2%，其中以伺服器為主的 IT 產品成長率高達 59%，繪圖卡與伺服器等敏感性產品成長最快。這些高科技產品製造需仰賴智慧製造技術，其背後的雲端服務支撐著資安系統與數位孿生等應用，傳統製造方式與 IT 架構已無法因應。

王定愷也同意此觀點，他指出相較於傳統 IT 部署，企業雲端部署可節省 90% 時間成本，將原本需 2 ~ 3 個月的廠房生產線 IT 部署縮短至約兩週。雲端提供的全球一致管理平台，也讓總部能與全球據點建構於同一系統上，大幅提升透明度、可問責性及全球 IT 管理效率，同時強化資訊安全。這不僅解決了傳統模式下各系統差異所需的額外整合成本，也為製造業因應全球部署等挑戰提供解決方案。



除了雲端外，AWS 在邊緣運算領域也已廣泛部署生態系統，王定愷表示，AWS 的邊緣裝置規模包含全球上億台 Alexa 裝置及超過 75 萬台機器人。邊緣運算趨勢也反映出製造業正面臨典範轉移，從傳統要求大規模生產量才願投入開發資源的模式，轉向動態且競爭激烈的環境，企業必須積極參與小型開發案例以累積經驗和專業知識，否則將面臨喪失市場參與資格的風險。面對小量客製化生產趨勢，他建議可採 Amazon 三大核心原則，包括問題解決導向、資料驅動決策及基層提案機制，這套方法論是 Amazon 能跨越多產業並持續創新的關鍵，也可作為台灣企業面對新製造典範的參考。

製造新模式轉向敏捷智造 邊緣運算助攻小量客製化轉型

黃欽勇最後強調小量採購生產製造 (small quantity sales) 對未來製造業的重要性，同時指出雲端服務架構設計需有效連結這一新興趨勢的關鍵挑戰。他認為亞馬遜憑藉其零售業的起源背景，已在小量處理領域累積了獨特且寶貴的經驗與專長，這些經驗值得台灣製造業深入借鏡與學習。王定愷也表示，AWS 在台灣建立區

域資料中心之舉，將為在地製造業轉型提供關鍵支援，面對小量多樣化客製生產的新時代，企業可善用雲端服務與邊緣運算優勢，以問題導向思維與資料驅動決策，藉由整合 AWS 的全球資源與台灣製造實力，台灣企業有機會在全球供應鏈重組中脫穎而出，創造更具彈性與競爭力的產業未來。

趨勢科技攜手 AWS

實現 AI for Security、Security for AI 營運願景



“面對企業整體資安防護力不斷提升，駭客正運用生成式 AI 加快研發惡意軟體的速度，也帶動全球吹起運用「AI 對抗 AI」資安防護新思維。具備強大算力、資源彈性調整、安全性、穩定性等多樣特色的 Amazon Web Services (AWS)，已成為資安業者發展 AI 模型與模擬攻擊測試的重要平台。

如趨勢科技在研發全球首個 AI 資安模型 -Cybertron 時，即選擇在 AWS 的平台上進行訓練與部署，利用 Amazon EC2 P5 執行個體 NVIDIA NeMo 端對端雲端原生架構等資源，大幅提升 Cybertron 模型的運算與應變速度，協助企業主動抵禦惡意威脅入侵。

”

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦表示，面對 AI 所帶來的風險與挑戰，趨勢科技從兩大面向著手，一方面運用 AI 技術融入資安產品與解決方案中，提高威脅預測與即時防禦能力；另一方面則推出保護 AI 模型安全的方案，防止模型被提示注入 (Prompt injection) 與資料外洩等問題。「我們與 AWS 合作超過 10 多年以上，

Trend Vision One 平台是趨勢資訊解決方案的重要核心，選擇部署在 Amazon 的關鍵，正是看準其具備高穩定度、高可靠度的特性，結合 Cybertron 模型，助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險、進行模擬演練，實現主動式防禦 (Proactive Security)。」

AWS 亞太 (台北) 區域 將成為企業佈局全球最佳後盾

過去幾年在疫情、戰爭、貿易衝突等眾多因素影響下，迫使全球供應鏈架構重組，更帶動企業加速數位轉型的浪潮。過去對上雲存有疑慮的金融、製造產業，正從過往傳統資訊架構轉向投入混合雲架構。AWS 具備區域性部署優勢與豐富的合規認證，能滿足歐盟 GDPR、台灣個資法、美國 CISA 等各國法規要求，讓企業在不違反法規前提下靈活調度資安資源，提升整體供應鏈韌性。

洪偉淦指出，多年前爆發美中貿易戰時，許多企業即開始調整全球供應鏈佈局，在評估改用混合雲架構時，也向趨勢科技諮詢用雲端資安解決方案。在此波對等關稅啟動後，企業用戶詢問度比過往更高，趨勢科

技是少數能提供混合雲端部署方案的廠商。加上 Trend Vision One 平台架構在 AWS 上，能提供用戶最需要的合規與風險控管機制，正是企業佈局全球的最佳後盾。在滿足全球市場對雲端運算需求，以及為台灣企業帶來全新數位轉型契機下，2025 年 AWS 宣布即將啟動 AWS 亞太 (台北) 區域，協助台灣企業享有資料本地化儲存、低延遲、合規性等功能。

面對日益嚴峻的資安威脅，趨勢科技將持續與 AWS 深入合作，投入創新科技開發與業務推廣，以 AI 強化資安防護 (AI for Security)，同時確保 AI 的安全 (Security for AI)，為全球用戶提供最完整的資安服務。



AWS 亞太 (台北) 區域

亞馬遜 AWS 為金融、製造和公部門等客戶提供高度安全的雲端基礎設施

2022 年以來，亞太地區穩定性排名第一*

*資料來源：
Frost & Sullivan 《Is Your Cloud Resilient Enough? What to Look for in Cloud Infrastructure Design, 2024》



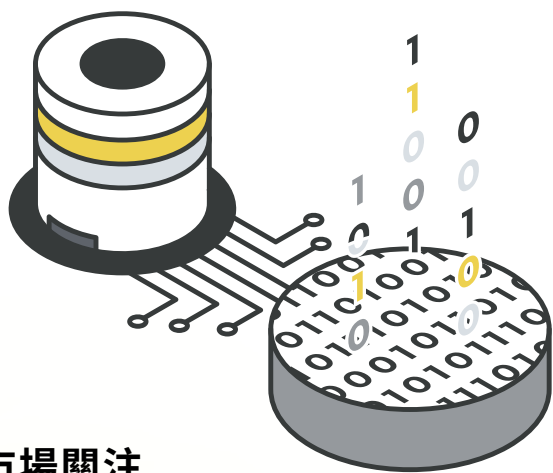
了解更多



AI 資源瓶頸 為 CXL 技術帶來市場轉機

相關軟硬生態系 2025 年有望大放異采

隨著 AI 大幅提升資料中心與伺服器發展運算力需求，沉寂一時的運算快取互連 (Compute Express Link；CXL) 協定標準，正透過突破性的互連架構與動態資源共享機制，推動資料中心轉型為更靈活、可動態調整的模組化運算環境。DIGITIMES 觀察，相關供應鏈正因應 CXL 快速形成，預期在 2025 年逐漸形成緊密的生態系。



CXL 直到 3.0 才受市場關注

CXL 經歷多次重大技術升級，直到 3.0 才獲市場關注。2019 年發布的 CXL 1.0 基於 PCIe 5.0，提供 CXL.io、CXL.cache、CXL.mem 三種協議，為 CPU 與加速器提供低延遲、高頻寬的互連方式，但當時既有 PCIe 與 DDR 記憶體架構足以支撐大多數應用。而 2020 年發布的 CXL 2.0 則帶來記憶體池化、持久型記憶體 (Persistent Memory；PMEM) 等支援，並引入 CXL 交換器概念，卻仍因市場需求不足而未獲青睞。

CXL 直到 3.0 以後逐漸被市場接受的原因，一方面是 CXL 傳輸效率漸趨完整，另外則因伺服器的高速傳輸需求暴增。2022 年釋出的 CXL 3.0 基於 PCIe 6.0，支援 64 GT/s 傳輸速率，並強化多層級交換 (multi-level switching) 能力，使記憶體共享更加高效。而接續的 CXL 3.1 則針對資料中心和高效能計算需求，增強記憶體池化和共享能力。

2023~2024 年生成式 AI 崛起，帶動 AI 伺服器對計算、記憶體與傳輸頻寬的更高要求。模型在訓練和推論階段，都要在極短時間內完成數據的讀取、處理和傳輸，任何一個環節的延遲都可能導致系統效能大幅下降，且運算過程高度依賴 HBM 與高速互連技術，代表傳統記憶體架構已無法應對這樣的負載。

因應龐大的運算力需求，業者除了選擇 NVIDIA 的產品與設計方案外，仍希望在產品設計上具備一定程度的掌控力，在此背景下掀起 CXL 應用的契機。



DIGITIMES 分析師 邱欣蕙

CXL 1.0~3.0 重點規格發展歷程

2024-2025	CXL 3.1 發布	· 強化安全性與一致性 · 傳輸效率優化
2022/8	CXL 3.0 發布	· 基於 PCIe 6.0，64 GT/s 傳輸速率 · 支援多層級交換 (multi-level switching)
2022	Intel Sapphire Rapids AMD Genoa	· 首款支援 CXL 1.1 處理器
2020/11	CXL 2.0 發布	· 新增記憶體池化 (memory pooling) · 支援單層級交換 (single-level switching)
2020/6	CXL 1.1 發布	· 兼容性與錯誤修復改進 · 增強安全性
2019/3	CXL 1.0 發布	· PCIe 5.0 · CXL.io、CXL.cache、CXL.mem 協議 · 低延遲、高頻寬 CPU 與加速器互連

資料來源：Compute Express Link，DIGITIMES 整理，2025/5

CXL 三階段技術發展 改善硬體資源運用效率

CXL 做為硬體互連技術，核心價值在於改變資料中心內部資源的管理與協同工作方式。透過記憶體擴展 (memory expansion)、記憶體共享 (memory sharing)、資源池化 (resource pooling) 三階段可降低總持有成本，並改善硬體資源運用效率。

初始階段的「記憶體擴展」方面，CXL 允許 CPU 以極低的延遲方式，存取外部 CXL 記憶體，即使內部 DRAM 容量有限，也能通過外部記憶體資源進行高效運算。

「記憶體共享」機制指多個處理器能同時存取，並共享同一個記憶體池。而共享機制的記憶體池化，正朝「資源池化」的概念發展。在 CXL 技術下，不論是 CPU、GPU 還是 FPGA，都能根據實際需求，動態調配各自的計算資源與記憶體。可在運行多任務、多應用場景中，依負載情況靈活分配計算與記憶體資源，避免單一伺服器內資源閒置或過度配置。DIGITIMES 認為，資源池化可視為 CXL 進一步推動資料中心靈活調度的關鍵，也是後續資料中心業者看重 CXL 的主因。

CXL 三大核心技術及優勢

CXL 核心技術

記憶體擴展 (Memory Expansion)

- 1 CXL 允許 CPU 以低延遲方式存取外部 CXL 記憶體，減少記憶體頻寬和容量的限制，使 AI 模型可處理更大規模的資料集。

記憶體共享 (Memory Sharing)

- 2 CXL 讓多個處理器共享相同的記憶體池，避免傳統 NUMA 架構高延遲存取問題，提升系統整體運行效率。

資源池化 (Resource Pooling)

- 3 CPU、GPU、FPGA 等可根據需求分配資源，提高資料中心的彈性與效率，避免單一伺服器內資源閒置或過度配置。

優勢展現

降低總持有成本 (TCO)

由於 CXL 能讓記憶體與加速器等資源更有效利用，業者可減少不必要的硬體擴充成本，從而降低整體擁有成本。

資料來源：DIGITIMES，2025/5

CXL 生態圈加速成型 2025 年生態圈建構完整大放異彩

英特爾、超微等處理器業者預計於 2025 年推出支援 CXL 3.0 的產品；而三星電子、美光、SK 海力士、SMART Modular、宜鼎等則計劃在 2025 年擴增 CXL 產品線；而互連技術業者 Xconn、Alphawave Semi 等，則積極推動 CXL Switch 技術；其他如 IP 與控制器、嵌入式解決方案等供應商均規劃 CXL 的支援與應用。

CXL 技術將帶動 AI 伺服器與資料中心架構演進，也促使企業加速採用更具彈性與擴展性的運算模式，讓 AI 訓練與推理能夠在資源調度最佳化的環境下運行。隨著供應鏈的深化布局、技術標準的成熟與終端應用的擴展，CXL 技術將驅動資料中心朝更靈活、模組化、低成本高效能的方向發展。相關供應鏈正因應 CXL 快速形成，預期在 2025 年逐漸形成緊密的生態系。

TEAMGROUP *Team*
十銓科技

COMPUTEX 2025

啟動 AI · 遊戲巔峰



GAMERS



CONTENT CREATORS



CLOUD / EDGE
COMPUTING



IOT / AI APPLICATION

臺北南港展覽館1館

J0617a



DIGITIMES APP

淬鍊知識，掌握未來
全方位行動服務讓您資訊不漏接

報導 提供科技產業、區域市場、智慧應用不同領域的即時、專業、豐富的內容，兼具速度、深度與廣度的產業鏈脈動資訊。

影音 聚焦產業動態、科技趨勢與人文視角，精選優質節目，帶您掌握最前沿的科技洞察與深度剖析。

活動 匯聚產業領袖、專家學者與分析師，深入探討最新科技趨勢與市場動態，分享前瞻洞見，協助企業掌握市場先機。

月 訂	季 訂	年 訂
600	1500	5200



立即訂閱



USB-C® Seamless Connectivity, Superior Visuals, Exceptional Experience

VL605

USB-C® DP to HDMI 2.1 PCON w/ USB PD 3.1

HDMI 2.1 FRL Certification
USB PD 3.1 EPR USB-IF Certification
TID: 10462

DP to HDMI 2.1

USB-C®

USB PD 3.1
EPR

VRR

Security

DSC

2-Port PD 8K@60 4K@240

VL832

USB4® Endpoint Device Controller

USB4 USB 40Gbps USB-IF Certification
TID: 10033

USB4®

USB 40Gbps

USB-C®

DP 1.4a

Security

USB 10Gbps Hub

4K 4K 4K 8K
4K@60 x2 4K@120 8K@60

VL109

3-Port USB PD 3.2 Controller for Docking

USB PD 3.2 EPR USB-IF Certification
TID: 12026

USB PD 3.2
EPR

Up to 240W

8-CH ADC

Power Delivery for



VL122

USB 2.0 Hub Controller

USB 2.0 USB-IF certification
TID: 12201

4 ports

STT

Industrial
Grade

Low Power
Design

Configurable

Integrated
Regulators



威鋒電子 COMPUTEX 展位資訊

VIA Labs, Inc. in USB-IF Community (Booth N0313)
NANGANG Exhibition Hall, Hall 1 International Exhibitors Area

VIA Labs, Inc. 威鋒電子股份有限公司

www.via-labs.com

USB Type-C®, USB-C® and USB4® are registered trademarks of USB Implementers Forum.



VLI Facebook



VLI Website

前進 COMPUTEX 施耐德電機重磅展示 AI-Ready 資料中心冷卻與設計能量

施耐德電機關鍵電力事業部
總經理 魏仕杰



施耐德電機攜手
Motivair Corporation
領航 AI 機房液冷未來

“因 AI 運算效能驟增且功耗擴大，導致伺服器冷卻方式面臨改變，漸從氣冷轉向液冷。據估計現今液冷市場年增率達 25~30%，預期 2026 年產值上看 60 億美元，儼然為大勢所趨；起因於 NVIDIA 晶片功率不斷走高，以 B200 為例便已逼近氣冷上限，展望未來如下一代 GB200 等，液冷模式將更具優勢。”

為此，施耐德電機 (Schneider Electric) 將 COMPUTEX 2025 參展的核心理念設定在「Grid to Chip, Chip to Chiller」，涵蓋從電網、晶片到冷卻的整體構面。施耐德電機關鍵電力事業部總經理魏仕杰表示，其展示內容橫跨中低壓產品、不斷電系統、PDU 排插、機櫃、空調及 CDU，堪稱最完整的 AI 資料中心方案，期望全面滿足來自伺服器業者、IDC 業者或機電業者等主力客戶或夥伴的種種需求。

液冷、新型 UPS 與監控軟體，有望贏得與會者關注

毋庸置疑，施耐德電機聚焦於三大領域：Grid to Chip to Chiller 端到端基礎設施、以軟體和數位孿生貫穿 AI-Ready 資料中心全生命週期、及永續發展諮詢服務，是展場當中一大吸睛標的。魏仕杰說，全方位 AI-Ready 資料中心解決方案從能源規劃出發，接著協助推動場地選址、產品選型、安裝施工，最終再藉助施耐德電機 EcoStruxure 等軟體，針對 AI 機房進行維運管理、能耗監測甚至永續規劃。顯見施耐德電機設定的 COMPUTEX 2025 展示環節，不僅涵括軟硬體產品，亦搭配一些規劃方案與顧問服務，形同一次呈現給客戶最豐富的 AI 機房知識饗宴。

本次展出重點之一，莫過於施耐德電機近期強化的液冷產品線。今年 (2025) 二月底，施耐德電機宣布已收購液冷技術專業廠商 Motivair Corporation 百分之七十五的控股權，預計於 2028 年完成所有併購程序，順勢取得包含冷板、分水管路、水冷背門、冷卻液分配單元 (CDU) 等備受好評的產品，大幅提升液冷產品佈局的完整性。此外，業者可搭配施耐德電機 EcoStruxure IT 智慧平台，結合 CFD 模擬與 AI 技術，即時調整冷卻配置，確保熱點處理精準，整體能效最大化。施耐德

電機也將展示新型不斷電系統 Galaxy VXL，可支援逾 5MW 容量 (並聯)，但 Footprint 甚小，一般競品的尺寸往往是它的 1.5~2 倍大；換言之客戶一旦採用 Galaxy VXL，就能在小面積內實現大功率，也算是一大節約。

除了硬體佈局，施耐德電機也在軟體領域加大投入，導入最新的數位孿生技術，實現資料中心從設計到營運的全生命週期優化管理。透過 ETAP 能源管理軟體，協助客戶進行電力系統規劃與模擬分析，預先計算保護協調、電力容量等關鍵指標，讓機房在動工前即能掌握潛在風險並優化配置。進入營運階段，業者也能運用 EcoStruxure Building Operation 樓宇管理系統，整合空調與冰水系統控制，提升能源使用效率；EcoStruxure Power Operation 電力監控系統則可即時掌握用電狀況、異常預警，並建構備援架構，有效降低電力中斷風險。進一步結合 EcoStruxure IT 資料中心基礎設施管理平台與 AVEVA Unified Operations Center 數位統一營運中心，實現跨據點集中監控與能效整合。而在推進永續管理方面，EcoStruxure Resource Advisor 提供碳排放來源追蹤與分析功能，協助業者精準掌握碳數據，持續優化資料中心的碳足跡表現。

從設計、選址、選型、施工到維運，打造完善 AI 基建方案

更重要的，施耐德電機亟欲彰顯的參展亮點並非產品，在於對伺服器業者、IDC 或機電廠商提供的機房設計規劃、端到端佈建、永續諮詢等服務助力。

魏仕杰指出，伺服器廠商以往負責推出伺服器標準品，銷往全球各國後再由當地 SI 夥伴協助整合到機櫃。如今需搭配液冷，且需消弭漏水風險，迫使伺服器廠商要在出廠前驗證無誤，之後再以整櫃 L11 方式出貨，意即一座機櫃裡已裝好伺服器、PDU 及分水管路。甚至當整櫃出貨到現場後，伺服器廠商亦需協助串接眾多纜線，如某業者曾出貨至挪威 66 櫃規模的 AI 機房，竟需要串接 8,000 條線路。

「不太可能有台廠願意投入二十多人、遠赴挪威駐點兩個月，只為執行接線工程」魏仕杰強調，施耐德電機作為全球性公司，一來在設計與規劃上，協助業者將伺服器、機櫃、配電與散熱等設備整合成完整的資料中心架構；二來無論銷售至哪一國，施耐德電機皆可安排適合的團隊，在兼顧施工品質與在地合規性下展開施工進程，協助業者快速解決交付難題、拓展海外生意。另以臺灣的 IDC 業者、機電廠商來說，仍普遍缺乏 AI 機房建造經驗。所以施耐德電機一樣透過設計、選址、選

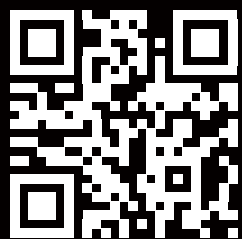
型、施工、維運到永續規劃等各個階段提供完整協助。截至目前，施耐德電機已協助多家臺灣業者建構 AI 資料中心，例如某業者欲出租算力給 Co-Location 客戶，施耐德電機協助其運用高水溫型列間空調，有效帶走每櫃 (主要安裝 NVIDIA H100 伺服器) 產生的 45KW 熱量，且完美達成 PUE 1.25 目標。

除此之外，施耐德電機也曾利用水冷模式幫助客戶實現 AI 機房散熱，主要提供機櫃、電力排插、UPS、中低壓盤等必要設施，再輔以「風牆」的搭建，不但打造完善的 AI 機房基礎設施，還能把 AI 晶片及其他基板零件的發熱一併帶走。

總括而論，施耐德電機不只擁有臺灣團隊，還有許多跨國團隊，多次受託於大型 CSP 執行 AI 機房興建案，因而累積諸多具參考複製價值的成功案例；甚至還推出一系列 AI 參考設計指南 (Reference Design)，可依電力容量、規格與建造模式的區別，提出設計範例或白皮書。因此客戶就算不清楚想要設計何等資料中心，亦能直接套用範例，得知例如蓋一座 1MW 資料中心需要配置多少變壓器、配電盤、機櫃、UPS 等，接著進行微調，便可加速達成前期設計目標。

Access the Intelligent Transformation

May 20 – 23, 2025
booth# J1217a



More Information



HEALTHCARE



NETWORKING/SERVER



TRANSPORTATION



AUTOMATION



SURVEILLANCE



CASINO GAMING



RUGGED SYSTEMS



RETAIL DEVICES

打造設計與量產的橋梁

Lynwave「ATM 整合方案」引領無線通訊高頻世代

綠億科技總經理吳三元，以逾十五年的深厚研發經驗，推出「ATM 整合設計方案」建立業界領先的一站式服務模式。

DIGITIMES 攝

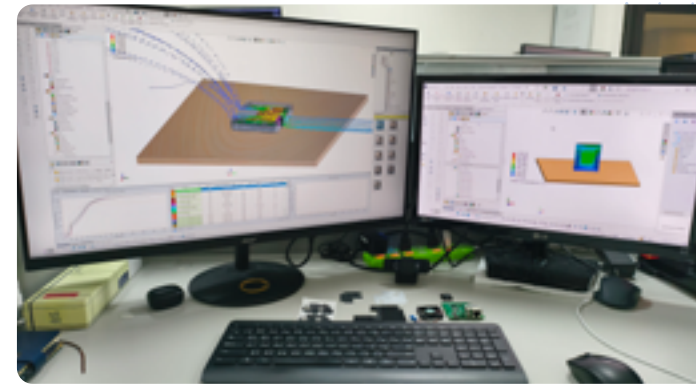


隨著無線通訊進入高頻、高功耗與極限空間的時代，傳統開發流程面臨嚴峻挑戰。綠億科技（Lynwave Technology）以逾十五年的深厚研發經驗，推出「ATM 整合設計方案」，將 Antenna（天線）、Thermal（散熱）與 Mainboard（主板）三大關鍵模組進行前期整合，協助品牌與 ODM 夥伴從設計起點就奠定效能與成本的優勢，並以模擬驅動開發流程，建立業界領先的一站式服務模式。

縮短設計與驗證週期的關鍵路徑

綠億科技總經理吳三元指出，過去許多網通裝置在開發過程中，天線、散熱與主板設計各自為政，團隊間溝通不易，導致反覆打樣、驗證，耗費大量時間與資源。「現在的 AIoT 設備越做越小，內建天線越來越多，功率也越來越高。這樣的變化下，傳統設計流程難以對應。」

為了解決這項挑戰，Lynwave 選擇「模擬先行」作為策略核心，導入 CST、Flotherm XT 等國際先進的模擬軟體工具，實現在產品成型之前即能精準掌握輻射場型、熱傳分佈與訊號完整性等關鍵參數。拜近年 GPU 計算效能大幅提升所賜，模擬精度與速度同步進化，使綠億能將虛擬設計直接無縫接軌至實體打樣，減少反覆開模、驗證成本。綠億的模擬流程可協助客戶縮短 30%-40% 的開發時間，產品效能提升幅度也達同樣數字，這在國際市場競爭中非常關鍵。



Lynwave 選擇「模擬先行」作為策略核心，導入國際先進的模擬軟體工具，使綠億能將虛擬設計直接無縫接軌至實體打樣，減少反覆開模、驗證成本。

DIGITIMES 攝

從天線到主板：一步一腳印的整合路徑

事實上，Lynwave 的 ATM 策略並非一蹴可幾。早年專注於高階天線設計的綠億，在五年前察覺到客戶產品對熱管理需求的急遽上升，便開始發展散熱模組設計與模擬能力。隨後，隨著高速傳輸標準演進，其開發重心再進一步擴展至主板結構的訊號完整性 (SI) 與電源完整性

(PI) 設計整合。

這樣的擴張策略背後，並非純技術堆疊，而是一套高度整合的系統性思維。綠億將過去分屬不同工程領域的三大模組，拉進同一套模擬流程與管理架構中，建立真正貫穿整體產品開發的工程邏輯與交付流程。

人才為本：跨域團隊是最大資本

整合設計的成功，離不開人才。不同於業界常見的「天線團隊 vs 散熱團隊」爭搶空間、各自為政的現象，Lynwave 打造一支橫跨物理、熱流、機構設計與通訊工程的研發團隊，且刻意招募具備雙領域以上專長的複合型工程師。綠億團隊裡，不少人同時熟悉天線模擬與熱模擬，甚至了解高速板設計的 SI/PI 要點。這樣的工程師在外面很少見，但綠億反而把它作為團隊組成的標準。

這種「跨域即戰力」的用人哲學，不僅強化內部協作效率，也讓綠億能以更迅速的時間完成產品整合。實際專案中，工程師可在毫米等級空間內快速取得天線與散熱配置的「甜蜜點」，讓產品同時達到高效能、高良率與最佳空間使用率。

案例實證：從最小 Wi-Fi 裝置到全球量產

Lynwave 曾承接一項全球體積最小 Wi-Fi 設備的開發案，因空間極限與高功耗特性，對天線設計與熱擴散構成雙重挑戰。團隊在天線結構中導入金屬接地板，不僅提升射頻性能，也順勢取代原有底部散熱片，有效降低 BOM 成本；同時在模擬階段反覆微調毫米內的散熱路徑與 PCB 配置，使此專案順利通過歐美日多國認證並進入量產。

另一典型案例則涉及高速傳輸主板的 PI/SI 優化：原本設計中因電源密度過高導致熱雜訊與眼圖失真，經模擬分析後，綠億工程師於關鍵節點配置電阻與電容，有效穩定輸出並重建訊號完整性，客戶因此省去重新佈局與開模的高額成本。

把握 Wi-Fi 8 世代轉型契機

隨著 Wi-Fi 8、5G NR-U 等高頻通訊規格逐步落地，產品功耗與散熱管理將進一步升級挑戰。綠億科技以 ATM 為核心，結合模擬技術與越南自有產線優勢，構築從設計到量產的彈性鏈結，已成功吸引多家國際品牌大廠採

用其設計方案，合作案年承接量超過 200 件，累積上千個專案經驗。客戶若選擇 ATM 整合模式，不但能把最困難的整合問題交由綠億處理，還能確保效能最大化與開發效率並進，讓產品上市更快、競爭力更強。

整合，是未來產品競爭的關鍵詞

在模組複雜度提升、產品周期縮短、供應鏈全球化的三重壓力下，企業唯有從設計起點就著眼整合，方能掌握全局。Lynwave 以 ATM 模式成功打造一條從研發、模

擬、驗證到交付的通訊產品設計新路徑，也為中小企業在高端市場中闢出一條具備全球競爭力的出路。

匠心工藝 打造儲存應用無限可能

Patriot 博帝創新 40 週年



科技網

即時新聞

觀點分析

產業情報

洞悉產業趨勢，驅動決策前行

每週提供百則以上新聞、相關議題及延伸閱讀，具即時性、效率性、豐富性，及對未來趨勢論點的探討延伸。重視各領域供應鏈之市場、產業、技術、產品等資訊的完整度與深度，讓讀者能以最快的時間掌握產業動態與趨勢。

試用申請



PEGATRON 強化 AI 伺服器到終端產品布局 深耕 AI 應用大戰略

和碩聯合科技 (Pegatron)
執行長 鄭光志

和碩聯合科技



2025 年接連的關稅大戰造成全球經濟情勢的劇烈震盪，台灣科技產業除了積極因應世局的變動之餘，仍重新盤點與聚焦技術創新的基本盤，當中人工智慧 (AI) 的發展不僅成為目前大家所極力追逐的重要成長的契機，而日常生活的智慧型應用範圍正因為 AI 而不斷擴大，積累更大的市場潛力並全面性改變人類的生活與產業的未來動態。

和碩聯合科技 (Pegatron) 執行長鄭光志接受這次的專訪，他從該公司目前對 AI 應用的綿密布局中分析進入雲端資料中心 AI 伺服器的挑戰，過去和碩從主機板、桌上型電腦、筆記型電腦、網通產品、智慧型手機，秉持著豐厚的產品發展經驗及生產流程的垂直整合製造能力，一路延伸到企業級伺服器產品線的發展過程，積累多樣化的技術實力，據此走向各方矚目與競爭劇烈的 AI 雲端中心伺服器產品線，面對一個嶄新的挑戰。

打造 AI 伺服器加入多樣化 AI 應用基礎設施的全球佈局

他描述AI 伺服器是多樣化智慧型應用的關鍵基礎設施，宛如建設一條重要的高速公路，就是為了讓更多的AI 驅動的智慧型應用得以暢行無阻，製造AI 伺服器不僅僅是電子、電路的設計而已，而是一個需要高整合與高密度技術的複雜任務，加上超高頻網路通訊、光通訊等專精技術，當中更牽涉到廣泛的軟體、多種複合型態散熱系統等同步整合的工作，尤其針對高效能運算GPU 晶片所需要的水冷式散熱系統的設計更是複雜的製程工藝的關鍵展現。

以和碩目前GB200 NVL72 這款DLC 液冷散熱機櫃為例，其通過CDU(冷卻分配單元) 來分配各個運算機台和交換機機台的散熱功率，實現快速液冷降溫效益。每個

運算機台內配備兩個GPU 冷板組，並通過不銹鋼管材串接，以滿足1U 高度伺服器機箱限制與組裝公差要求；再加上該系統是液、氣混合的整體散熱方案，考量整機的纜線布線，以及水管的複雜排列，採取從單相到雙相的水路系統設計，還同步設計並分配空氣流場以滿足空氣端的散熱需求。

和碩為了確保水冷系統的可靠性，大舉發展諸如BMC 等精密的遠端監控軟體系統，同步監控漏水風險並主動考量與資料中心內部空間冷卻系統的整體效益，並積極參與未來資料中心產業的端對端的機房控制解決方案，這一路從軟體、機構與光學等關鍵技術的投資才能進入這個一級戰區的市場。

持續耕耘北美四大 CSP 高階 AI 伺服器與主權 AI 資料中心的供應鏈

這些努力自 2025 年開始有了重要斬獲，除了透過 NVIDIA 的合作讓 GB200 NVL72 系統成功切入指標性客戶 Lambda Lab. 並獲得接續的新訂單之外，還同時在半導體晶圓代工大廠的企業級的伺服器的訂單獲得重要的收穫，可望迎接進一步挹注重要營收的機會。在這些成功基礎下，和碩積極參與下一代 AI 伺服器 Blackwell Ultra 產品 GB300 NVL72 與 HGX B300 NVL16 的合作計畫，將成為 NVIDIA 的高端資料中心產品的首波 ODM 廠商之一。再者，對於旺盛的新興國家與國家級

主權 AI 資料中心的建案開展更大的商機。

這些努力與準備讓和碩設定切入全美四大指標性 CSP 的 AI 伺服器供應鏈的重要目標。鄭光志信心滿滿的表示達成這個新目標，除了技術與供應鏈夥伴的管理能力之外，更重要的是製造規模與在地化的製造基地的全球佈局能力，目前除了將台灣的製造基地擴增之外，在北美的製造基地，除了已知的墨西哥廠區的擴增之外，和碩在美國本土的製造計畫也預計在今年第二季會定案。

瞄準邊緣運算與終端 AI 應用，四大產品聚焦 Computex 2025 大展

隨著高效能運算晶片的算力增長及省電的優勢，人工智慧走向邊緣裝置的趨勢正當紅，鄭光志看到更多貼近於消費者 AI 應用的商品成為主要的成長動能，舉凡智慧家居、穿戴式裝置，乃至於智慧醫療裝置，甚至能實現更自然的人機互動的人型機器人的演進，都讓具備更個性化、更貼心與唾手可得的貼身助理等應用將可以大行其道。

這些新型態的 AI 邊緣裝置與終端應用都看到包括 AI 模型及應用佈署、光電融合技術、感測技術、穿戴式裝置及仿生機器人的相關主流技術直接呈現，具備著更快速的反應速度，尤其在低延遲、即時互動的應用，帶來更多令人耳目一新的產品，舉凡 AR/VR 智慧型眼鏡和自駕科技的再進化而形成新概念的商品，這就像前述場景所揭露的一旦高速公路建好了之後，各式各樣的 AI 跑車就可以盡情馳騁於路上，快速攫取市場創造驚人商機。

為了進一步了解和碩在 AI 的戰略布局，今年在 Computex 2025 展覽中將以「TECH」為四大主題的核心展示，聚焦於「T」是通訊與網路 (Telecommunication and networking)、「E」指電動車與行動裝置 (Electronic mobility)、「C」則是消費性電子與智慧醫療裝置 (Consumers & health)，以及「H」是高效能運算 (High performance computing) 也就是雲端 AI 伺服器系統的新發展，更多的產品展示涵蓋從低軌衛星相關解決方案、完整的伺服器系統、車用智慧座艙到諸如智慧藍芽安全帽、美容儀、智慧眼鏡、輔聽耳機裝置等個人健康設備。

誠如鄭光志所說，追求科技與生活的無縫接軌的需求仍不斷創造更大的市場機會，他對於 AI 帶來的生活與工作上更美好的展望，充滿期待，和碩透過 Computex 2025 大展中將以更活潑的面貌塑造其在代工製造與打造端對端解決方案的技術的市場價值，偕同客戶一起迎接 AI 應用所即將帶來的十到二十年的榮景。

BIOSTAR 映泰 推出 EdgeComp 系列 MS-X6413E 與 MS-N97 工業電腦 強化自動化與邊緣運算佈局

掌握智慧工業脈動，推出 EdgeComp 新作

國際工業電腦與邊緣 AI 運算領導品牌 BIOSTAR 映泰，正式推出 EdgeComp 系列新世代工業電腦——MS-X6413E 與 MS-N97，全面滿足工業自動化、邊緣運算、HMI 及數位看板應用，助力企業加速數位轉型。

EdgeComp MS-X6413E：超低功耗自動化利器

搭載 Intel Atom x6413E 四核心處理器，EdgeComp MS-X6413E 以 9W 超低功耗設計及無風扇散熱架構，提供長時間穩定運作。內建雙 2.5GbE 高速網路、支援雙螢幕輸出、內建 Mini PCIe 插槽可外接 WiFi/BT 模組或搭配 4G/5G SIM 卡，適用於 IOT 設備。此外，EdgeComp

MS-X6413E 具有多組 COM 埠，可外接多組專業設備，適用於 POS 收銀、自助服務系統。針對工業自動化需求，EdgeComp MS-X6413E 可適用於環境溫度 -30°C~70°C 工作溫度及支援寬壓 9~24V，更適合使用在工業控制領域。

EdgeComp MS-N97：靈活擴充，應對多元場景

EdgeComp MS-N97 使用強固型機構設計並採用 Intel Alder Lake-N N97 處理器，支援最高 16GB DDR5 記憶體，內建雙 2.5GbE 高速網路並具備 HDMI 與 DP 雙視訊輸出。擴展靈活性高的 EdgeComp MS-N97 還內建 M.2 Key M/

Key B 及 Mini PCIe 插槽，搭配可輸入電壓 9~24V 寬壓設計，適應各類嚴苛環境，廣泛應用於邊緣即時運算與數位看板建置。

BIOSTAR 映泰持續引領智慧工業未來

EdgeComp 系列產品以高速連接、多重擴充與卓越耐用性為核心，協助企業提升管理效率、自動化控制效能及邊緣智慧部署，加速智慧製造與數位轉型布局。

智慧零售 智能自動 邊緣運算 IPC 專業夥伴

映泰
BIOSTAR



MS-N97



MS-X6413E



BIW88-AHS

智微科技偕同開酷科技於 COMPUTEX 展示最新 RAID 存儲解決方案與人工智慧感測技術

在 2025 年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2025) 中，高速傳輸橋接晶片領導廠商智微科技 (4925) 攜手其全資子公司開酷科技，重磅推出最新一代高速存儲橋接晶片解決方案，展現新型態外接存儲的應用趨勢。同時，亦同步揭露基於 60GHz 毫米波雷達技術的 DSP 與 AI 感測技術，為智慧家居帶來嶄新體驗。

智微科技本次展出重點為全新一代高速傳輸橋接晶片，包括 JMS591 與 JMB595 兩款關鍵產品。JMS591 (USB 3.2 Gen2 x2 & eSATA 6Gb/s to 5 ports SATA 6Gb/s) 為多盤位硬體 RAID 解決方案，其單晶片設計支援 RAID 0/1/5/10/JBOD，讀寫速度高達 2,000 MB/s，並具備風扇與 LCM 顯示器控制功能。相比現有解決方案，JMS591 在傳輸速度、RAID 穩定性與效能上皆有大幅躍升，預期將廣泛應用在網路附接儲存裝置 (NAS)、多硬盤 RAID 外接存儲裝置 (DAS)、錄影後台多存儲裝置主機 (NVR) 和傳統監視器多存儲裝置主機 (DVR) 等，需要配置多存儲裝置的各類主機應用，提供市場高性價比的多盤位磁碟陣列解決方案，持續獲得市場高度關注。另一款 JMB595 (PCIe Gen4x4 to 16 ports SATA 6Gb/s) 則為多盤位存儲解決方案原型，適用於高階安防儲存與私有雲應用，同時也為入門級儲存伺服器市場帶來新選擇，備受產業期待。

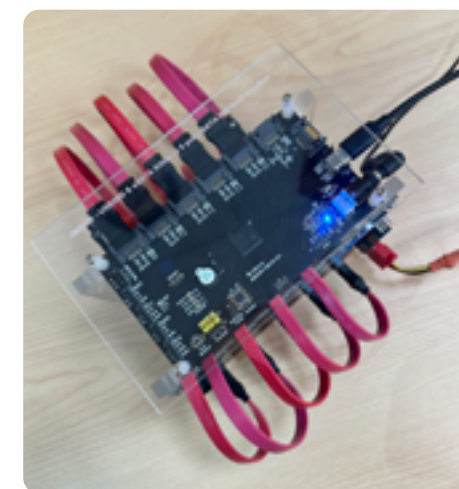
智微科技行銷業務副總經理林明正表示：「我們以深厚的技術積累與市場領導地位，引領高速傳輸與儲存應用的發展方向，攜手主要客戶，共同推進新世代橋接控制晶片的創新與落地。」

開酷科技則展示其最新基於 60GHz 毫米波雷達的 AI 感測技術，整合自研天線設計、先進 DSP 與 AI 加速器，搭配獨家演算法，實現高精度行為追蹤與定位辨識，突破傳統智慧家居在人員感測方面的技術瓶頸。例如，智能電子鎖可根據毫米波雷達準確偵測人員接近，並觸發人臉辨識或其他解鎖程序；風扇與冷氣則能追蹤用戶所在位置，實現「風隨人動」、溫度個人化等智慧控制；電視更可依據觀眾方位自動調整音場，提供更沉浸的觀影體驗。此創新技術不僅賦予電子鎖、冷氣、風扇與電視等家電嶄新互動能力，更憑藉低功耗、小體積、免開孔設計，大幅降低總體擁有成本 (TCO)，同時達到節能減碳的效果，為消費性電子市場樹立新標竿。

開酷科技總經理王君弘指出：「我們長期致力於毫米波雷達與 DSP 以及 AI 技術的融合應用，目標是打造更智慧、直覺的人機互動介面。60GHz 毫米波雷達的應用是一大突破，不僅解決智慧家居的感測挑戰，更為用戶帶來前所未有的便利與體驗。我們也期盼將此技術擴展至工業與物聯網場域。」

憑藉 DSP/ AI/ ML 技術與天線設計的領先優勢，開酷科技持續展現技術創新的實力。隨著非接觸式與智慧化需求日益提升，毫米波雷達的應用前景看俏。開酷科技正積極與全球合作夥伴推動技術落地，並計畫於 2025 年下半年推出更多搭載該技術的終端產品，為產業注入創新動能，預計將引領下一波智慧家居革命。

誠摯邀請產業先進蒞臨 COMPUTEX 展會，參觀智微科技與開酷科技於六福萬怡酒店「海廳」展區，交流指教，共同見證技術創新帶來的智慧生活新未來。



JMS591 多盤位硬體磁碟陣列解決方案。智微科技

10 年一周期

量子電腦以實現計算優越性為目標

近期量子電腦商用時程引發熱議，各界多認為技術仍面臨挑戰，尚需多年研發才具商業價值。其關鍵難題在於量子態不穩定，易受環境干擾塌縮，影響計算準確性。各家投入量子電腦的業者等正專注於量子糾錯 (QEC) 技術，以克服退相干 (decoherence) 與干擾 (noise) 問題，目標 10 年內實現量子計算優越性 (quantum supremacy)。

量子三元素 疊加、糾纏與不可複製性

量子電腦為運用量子比特 (Qubit)，採用 Shor 或 Grover 演算法計算的裝置。量子比特的三大特性為疊加 (superposition)、糾纏 (entanglement) 和不可複製 (no cloning)，疊加指量子比特可處於 0 和 1 的線性組合態，使量子電腦同時計算多種可能

性，與經典電腦依序計算不同；糾纏指兩個量子比特的緊密連動關係，能減少計算步驟，提高運算效率；而不可複製性使量子資訊難以直接儲存或備份，增加錯誤校正與數據處理的難度，但在量子通訊中，這一特性能防止訊息被竊取，確保通訊安全。

量子比特三大特性示意圖

疊加

和經典電腦的古典比特「非 0 即 1」有所不同，量子比特可處於 0 和 1 的線性組合疊加態。

以布洛赫球面 (Bloch Sphere) 呈現量子狀態。

糾纏

即使一對糾纏量子比特相距遙遠，也可透過測量其中一個量子比特的狀態，來了解另一個量子比特的狀態。

左邊綠色小人和右邊紅色小人代表兩個量子，兩個量子無論距離多遠，因糾纏態而互相影響。

不可複製原理

無法構造出一個可以完全複製任意量子比特，且同時不干擾原始量子比特的系統。

$|\psi\rangle$ 表示量子態，輸入機器 (箱子) 後，不可能產生兩個完全相同的量子態。

資料來源：DIGITIMES 整理，2025/4



DIGITIMES 分析師 黃雅芝

黃雅芝

顛覆未來仍難以落地 量子電腦的現實挑戰

建造量子電腦極具挑戰，量子比特在計算過程中必須維持穩定，否則運算將無法進行，這種特性稱為「相干性 (coherence)」。

量子態維持的時間稱為「相干時間 (coherence time)」，以超導量子電腦 (SQC) 為例，通常僅有 0.1 至 1 毫秒。在此期間，量子比特必須避免環境干擾，否則可能與外界產生糾纏並失去穩定狀態，導致計算結果不可預測，這種現象稱為「退相干」，是量子電腦發展的最大障礙。

隨著量子比特增加，退相干風險也提升，因為糾纏變得更複雜，外界干擾影響更大，操控難度隨之上升。為降低錯誤率，科學家透過量子糾錯補償干擾，但這需要大量額外的量子比特，增加硬體需求與成本。因此，如何擴展量子比特規模並抑制退相干，仍是量子電腦商用化的關鍵。

量子糾錯 突破量子電腦瓶頸的解方

量子糾錯技術將邏輯量子比特的訊息分散至多個物理量子比特，補償環境噪音造成的退相干，從而延長量子比特壽命並保持數據完整性，不同硬體架構需採用不同的糾錯方法。

構建一個邏輯量子比特通常需要 1,000 至 10,000 個物理量子比特，而要實現通用型量子電腦，至少需 1,000 個邏輯量子比特，所以需要 100~1,000 萬個物理量子比特。

目前，各公司可操控的物理量子比特至多約 1,000 個，但實際形成的邏輯量子比特極少，遠不能支撐有效的量子計算。因此，當前的量子電腦仍處於技術探索階段，距離真正商用化尚有一段距離。

量子電腦架構比一比：超導、離子阱、光量子誰領先？

量子電腦的硬體技術可分為兩大類，也就是人造粒子與天然粒子，前者包含超導、矽量子點與拓撲量子比特 (topological quantum bit)，後者涵蓋離子阱與光子量子比特 (photons as qubits)。在錯誤率方面，超導與離子阱最低，約 0.1%；矽量子點次之，約為 1%；光量子則較高，達 10%。

從業界布局來看，中國科學院與中國科大皆專注於超導、矽量子點及光子量子比特技術。美國 IonQ 與 Quantinuum 聚焦離子阱，而 PsiQuantum 與加拿大 Xanadu 則專研光量子。

不同架構各有優缺點，超導與矽量子點需在極低溫環境運行以維持量子態；離子阱穩定且準確，但計算速度較慢，並需配置大型雷射系統；光量子可在室溫運作，但單光子的發射與控制仍是技術挑戰。

量子電腦各式硬體架構優缺點比較

✓ 優點

✗ 缺點

超導

· 技術突破快速，是最成熟的方案

· 量子態極容易塌縮 (Collapse)
· 必須保持極低溫才能穩定工作

矽量子點

· 仰賴成熟的半導體奈米結構技術

· 糾纏數量少運算效率較低；必須保持低溫

拓樸量子比特

· 穩定度最高，錯誤率大幅降低

· 在所有方案中最難實作

離子阱

· 囚禁離子和量子門穩定性皆佳
· 機率運算結果具信賴度· 運算速度慢，且必須處於真空狀態
· 需搭配大型雷射系統，增加開發難度

光子量子比特

· 可在室溫下操作

· 實現高效率且穩定的單光子源具極大挑戰

資料來源：DIGITIMES 整理，2025/4

量子電腦現階段以發揮計算優越性為目標 尚缺乏實用性

量子電腦的發展可分為三個階段，每 10 年為一個里程碑，目前正值第一階段，以實現量子優越性為目標，也就是找出優於經典電腦且具實用性的計算領域。目前量子電腦仍缺乏實用價值，例如量子電腦可計算咖啡杯摔碎後碎片的所有可能軌跡，儘管經典電腦可能需耗時 1 年，但這類問題對現實應用幫助不大。

第二階段量子電腦將發展專用模擬器，輔助經典電腦處理量子化學、藥物開發與材料研究等特定任務，例如賓士與 IBM Quantum 研究鋰硫電池，福特利用量子比特分析電池材料。

第三階段目標是開發通用型量子電腦，即能容忍計算誤差並適用各類問題。然而，這需操控數十萬至數百萬個量子比特，並克服穩定性與精確度挑戰，技術難度堪比可控核融合。

當前量子電腦仍面臨穩定性與計算精確度的挑戰，距離真正商業化仍有一段路要走。

2023 » 2025 全球伺服器供應鏈 設廠現況與分析

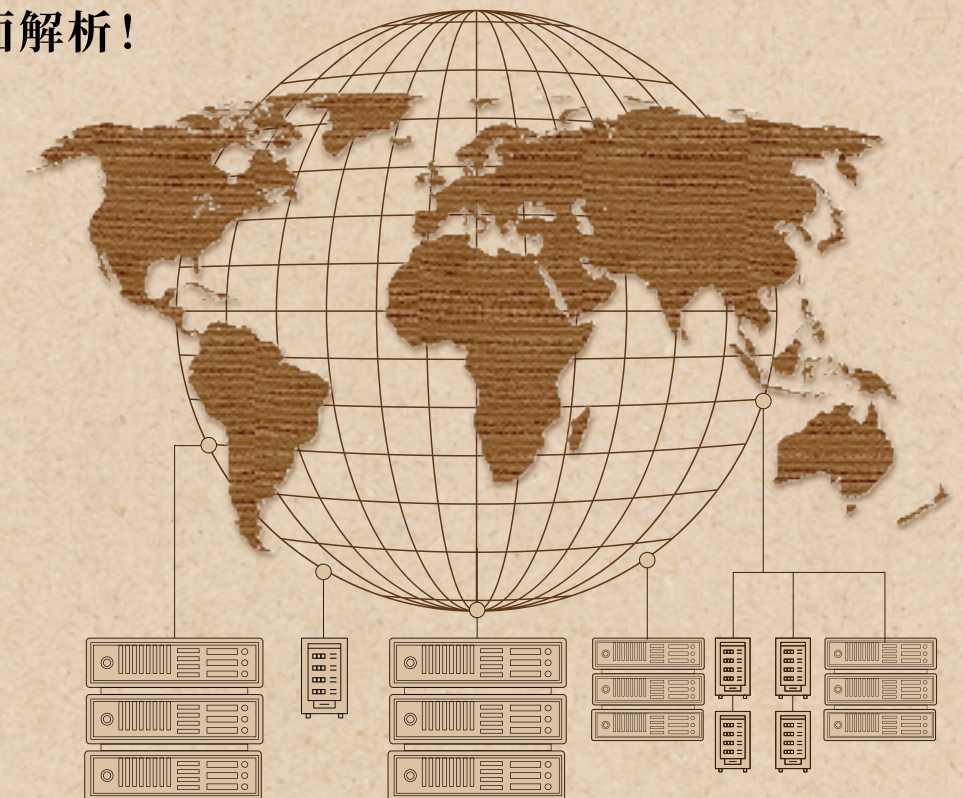
6大EMS廠

500⁺筆業者資訊

Google直覺式互動地圖

詳細盤點EMS各工廠，抓緊供應鏈關係脈絡

DIGITIMES針對台系、中系主要EMS業者的生產據點進行細緻盤點，分析近3年來、超過500筆的伺服器供應鏈相關資訊，透過交叉比對後，剖析出零組件來源、EMS生產據點、以及最終客戶位置等資料，以圖像化的方式呈現出伺服器EMS供應鏈的布局，解析在AI熱潮與地緣政治衝擊下，市場最核心關注的科技產業環節。

台系業者市佔持續擴大
供應鏈布局全面解析！

Amphenol

05.20-05.23

攤位號碼: I1317 (台北南港展覽館一館 1F)



COMPUTEX
TAIPEI

Amphenol 與您攜手共創 AI 革命

過去十年,大型資料中心進步飛速,也讓全球每年數據量以數兆 gigabytes 飛躍性成長,進一步推動人工智慧(AI)協助人類達到新高度。但 Amphenol 知道, AI 技術背後的運算能力與架構非一朝一夕可以實現。

本次 Amphenol 非常榮幸推出「The Body of AI」主題專區,將聚焦於主流 AI 系統的架構,並展示大型資料中心是怎麼藉由 Amphenol 的電力、連結解決方案,推動 AI 和機器學習實際運作。身為全球最先進連接器製造商之一,Amphenol 將由旗下 13 個核心事業部聯合展出,陣容堅強。

Amphenol 展位重點解決方案包括

- 高速背板連接器
- 高速 I/O 介面
- 高速板對板連接器
- 伺服器儲存 I/O
- 光纖連接解
- 照明產品
- 背板線纜組件
- 高電流電源連接器
- 商業 I/O 及線纜解決方案
- 產業標準介面
- 防水 I/O 產品
- 液體冷卻解決方案

詳細了解 Amphenol 如何推動這場科技革命,
並期待與您共創 AI 美好願景。



官方網站



linkedin



facebook

廣和通 AI 能力與產品升級

助智慧硬體企業熱烈擁抱 AI

人工智慧 (AI) 浪潮正重塑全球產業格局，無線通信與 AI 的融合加速推動 AIoT 邁入新階段。多樣化的智慧應用場景亟需兼顧效能、能耗與成本，才能實現真正落地。作為全球領先的無線通信模組與 AI 解決方案提供商，廣和通 (Fibocom) 正以 AI 平臺思維重塑核心能力，推動 AI 與通信的深度融合，為產業帶來全新智慧升級契機。



過去通信模組的核心價值是『連接』，如今我們看到 AI 能力正快速向終端擴展，讓模組成為具備計算、感知與決策能力的『智慧中心』，」廣和通 CEO 應凌鵬指出。「『端雲協同』正是 AI 與通信融合價值的體現，模組的角色正在被重新定義。」

軟硬整合，廣和通全棧式解決方案賦能萬物智聯

廣和通憑藉在無線通信、AI 技術與軟硬整合的深厚實力，積極佈局邊緣運算節點，推動終端 AI 化。公司推出「AI For X」，宣佈以全方位、多方式的 AI 技術能力、產品、行業解決方案、生態融合助力多行業從“互聯萬物”向“智聯萬物”躍遷。在 AI 應用和技術落地上，廣和通聚焦智慧型機器人、自動駕駛、工業控制、智慧零售等多元垂直場景，提供靈活的 AI 解決方案與應用範例。針對輕量化 AI 需求，廣和通則推出搭載語音與視覺交互能力的 AI 大模型解決方案，支援 AI 玩具、智慧音箱等設備智慧

升級；而在端側 AI 領域，星雲系列、天擎等解決方案具備將大模型部署至設備端的能力，大幅降低時延與能耗，提升即時反應與用戶體驗。

廣和通全棧式解決方案覆蓋 AIoT 模組、AI 模型、智慧體、全球資費和雲服務，助力智慧型機器人、消費電子、低空經濟、智慧駕駛、智慧零售、智慧能源等行業數智化升級。這些解決方案均建構於「軟硬整合、全棧協同」理念之上，鞏固廣和通在 AIoT 平臺的領導地位。

AI + 垂直應用場景，加速終端硬體商用與驗證

近年，廣和通積極佈局智慧型機器人，其自研的具身智能開發平臺 Fibot 結合 AI 演算法、IoT 連接與自動化控制，成功協助多家國際一線機器人品牌提升產品智能化水準。特別值得一提的是，廣和通於 2025 年推出全球首款“純視覺”智慧割草機方案，全程不依賴物理邊界設置或基站輔助，單靠機器視覺與 AI 演算法即能實現精準導航與避障功能，真正落實“感知即行動”的技術突破。「純視覺不僅是一項技術創新，更預示智慧設備演進的未來方向，」應凌鵬指出。該方案已於歐洲多國上市，並於德國權威媒體 Heimwerker 評測中獲得五星滿分評價，充

分展現廣和通 AI 技術的實用性與全球競爭力。

此外，廣和通也深耕 5G FWA 應用場景，推出整合 AI 算力與通信能力的「天擎平臺」，重新定義 FWA 終端價值。該平臺具備本地 AI 推理、多任務並發與設備協同能力，可作為智慧家庭、遠距辦公、影音處理等邊緣應用的核心樞紐“超級智慧體”，協助電信業者從「賣流量」轉型為「提供智慧服務」。

透過「演算法 + 算力」雙軌策略，廣和通正加速 AI 垂直應用的落地進程，展現其從通信模組供應商轉型為 AI 解決方案領導者的堅實步伐與前瞻佈局。

AI 融合挑戰與創新能力的全面支持

面對終端 AI 化的加速發展，廣和通也洞察其中挑戰，並提出系統性的應對策略。首先，在資料安全與隱私保護方面，廣和通於產品設計階段即貫徹「資料最小化」原則，強化本地處理能力，降低數據外洩風險，全面提升用戶信任感。其次，針對低功耗的應用需求，廣和通打造兼具高效能與低能耗的 AI 硬體解決方案，從半導體晶片架構到演算法層層優化，實現資源調度最優化。第三，在算力與生態協作挑戰方面，廣和通積極構建開放靈活的協同平臺，助力客戶與合作夥伴共

用 AI 技術紅利，加速多樣化應用場景的落地。

應凌鵬表示，「我們堅持長期主義，圍繞價值商用與規模化，聚焦端側 AI 解決方案，穩步推進 AI 與通信的融合落地，模組是最貼近終端的數據入口，未來也將成為 AI 能力釋放的關鍵出口。」站在 AI 浪潮的十字路口，廣和通將持續以 AI 引擎提供萬物智慧化的底層的最大支撐，驅動 AIoT 產業邁向全新階段的飛躍。

降低功耗、熱能產生和費用。比免費晶片更低的 TCO 可靠性是 AI 真正的門檻



“在現今 AI 驅動的經濟環境中，可靠性不再是額外的優勢，而是基本門檻。AI 應用已經進入工廠生產線、智慧城市與配送機器人，一秒的停頓可能導致生產線中斷、違法安全規則或客戶信任流失，而代價可能高達數百萬美元。任何無法全天候穩定運行的 AI 系統，在現實世界中都無法真正應用。

AI 在邊緣運算環境中必須符合四大嚴格條件：

- 延遲低於 100 毫秒
- 功耗保持在 5-20W
- 99.999% 的穩定運行時間
- 接面溫度低於 85° C

如果這些條件無法滿足，AI 系統可能會過熱、速度下降，甚至現場運行時發生故障。

”

DEEPX DX-M1：專為穩定性設計的 AI 晶片

基於 GPGPU 架構的 AI 系統通常難以符合這些條件，功耗超過 40W，不僅超出機器人電池負荷，也讓風扇、散熱片與通風系統成為必要配置，導致噪音增加、成本上升，導致因額外故障點提高維護需求。此外，其對雲端運算的依賴導致頻寬費用與延遲問題，影響實際應用效能。

DEEPX 重新定義 AI 硬體的標準。DX-M1 晶片在功耗低於 3W 的情況下，提供可媲美 GPGPU 的 AI 精準度。在 YOLOv7 33 FPS 工作負載下，DX-M1 的溫度穩定於 61.9° C，而某知名競爭對手則高達 113.5° C，已達過熱降頻門檻。在

最高負載下，DX-M1 仍能保持 75.4° C，並以 59 FPS 運行，而對手產品僅達 32 FPS，溫度更高達 114.3° C。這顯示 DX-M1 在效能上提升 84%，而溫度確比對手低 38.9C，不僅提高穩定性，也確保長期可靠運行。

DX-M1 透過巧妙的架構設計，平衡速度與穩定性，不同於一些無 DRAM 設計的 NPU，只依賴片上 SRAM，導致過熱、延遲增加與生產良率下降，DX-M1 結合高效 SRAM 與 LPDDR5 DRAM，確保 AI 運算穩定流暢，同時降低 90% 的硬體與耗電量成本。



隱藏的 AI 硬體成本：不只是標價

DEEPX 近期協助兩家企業開發 AI 工廠機器人與本地伺服器系統，初期規劃採用 40W GPGPU，但測試後發現以下隱藏成本：

- 若 40W GPGPU 持續運行 5 年，光是電費成本就超過 DX-M1 晶片價格的兩倍。
- 高溫環境需要散熱系統，額外消耗電力並增加維護負擔。

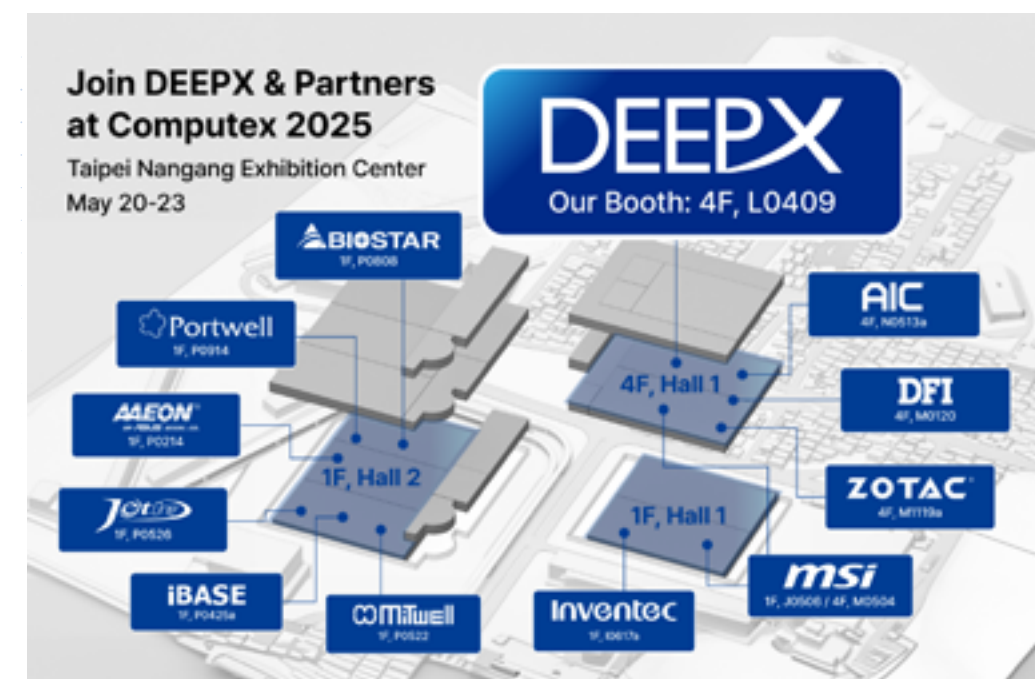
即使硬體免費，長期運行成本仍超過 DX-M1 的兩倍以上。這些企業在測試多家 NPU 供應商後，發現 DX-M1 在功耗、散熱與精準度方面最符合大規模應用需求。與 GPGPU 系統相比，DX-M1 在 5 年內可降低約 94% 的電力與散熱成本，大幅減少長期營運開支。

AI 的未來：速度之外，更是可靠性

AI 發展不僅關乎算力或模型規模，更重要的是能否提供穩定、可預測的性能，確保 AI 在現實環境中成功運行。無論是智慧工廠、智慧城市或機器人應用，哪怕一秒的延遲，都可能導致系統故障、風險增加或企業信任下降。因此，可靠

性不僅重要，更是 AI 長期成功的關鍵。

透過 DEEPX DX-M1 晶片，降低能耗、縮減長期運行成本，打造真正能獨立運行、穩定可靠、不間斷運作的 AI 解決方案。



焦點廠商

十銓科技股份有限公司

攤位號碼 J0617a

TEAMGROUP
十銓科技

電話 +886-2-82265000

官網 www.teamgroupinc.com

全球記憶體領導品牌十銓科技將盛大參展 COMPUTEX 2025，以「啟動 AI・遊戲巔峰」為主題，於南港展覽館一館 J0617a 展位發表多項專為 AI、創作者、電競與企業應用打造的創新儲存與記憶體解決方案，全方位產品陣容，擘劃展現完整技術實力與對未來運算趨勢的深度掌握，引領智慧運算與高效能應用邁入嶄新紀元。

台灣廣和通電子股份有限公司

攤位號碼 K0727a

Fibocom

電話

官網 www.fibocom.com

廣和通始創於 1999 年，是中國首家上市的無線通信模組企業。廣和通全棧式解決方案覆蓋 AIoT 模組、AI 模型、智能體、全球資費和雲服務，助力智能機器人、消費電子、低空經濟、智能駕駛、智慧零售、智慧能源等行業數智化升級。——構築數字世界基石，豐富智慧生活！

卡爾蔡司股份有限公司

攤位號碼 I0318

ZEISS

電話 +886-3-5753747

官網 www.zeiss.com.tw

2025 COMPUTEX 與蔡司一同見證 AI 硬體品質實力全新高度。隨著 AI 伺服器設計與製造邁向更高的精度與複雜性，品質已不只是最終驗收的標準，而是驅動效能與交付的核心戰略。蔡司更是打造完整 AI 伺服器架構不可或缺的關鍵拼圖。

台灣鎧俠股份有限公司

攤位號碼 X0001

KIOXIA

電話 +886-2-25089909

官網 tw.kioxia.com

台灣鎧俠股份有限公司參展 COMPUTEX 2025，於南港展覽館二館三樓 X0001 展位展出其快閃記憶體及 SSD 相關解決方案，在商用及消費級領域併進，帶來相關領域前端發展及最新技術，與產業一同在 AI 需求爆發的時代推進創新。

宇瞻科技股份有限公司

攤位號碼 J1217a

Apacer
Access the best

電話 +886-22678000

官網 www.apacer.com

技術有針對穩定電壓開發的 CoreVolt 2 與節省能耗的 CoreEnergy，工控產品則有 BiCS 8、相容於樹梅派平台的 SSD、與適用 AI PC 的 CAMM2；消費性產品有磁吸 SSD 以及電競 RGB DDR5。對於永續浪潮，宇瞻亦有香氛 SSD、電子紙、全無鉛 SSD 與 DRAM 產品滿足客戶需求。

和碩聯合科技股份有限公司

攤位號碼 L0118

PEGATRON

電話 +886-2-81439001 官網 www.pegatroncorp.com

和碩以 TECH Maker 聚焦四大主題。T 區為 PEGATRON 5G 團隊 AI 驅動端到端系統與應用方案。E 區聚焦車用電子展示智慧連網的未來實力。C 區聚焦個人穿戴與輔助生活 AR 智慧眼鏡以及為低視能者打造視網膜投影儀和高階美容護膚儀。H 區為高效能 AI 運算模組，與頂尖夥伴合作開發的 GPU 伺服器與資料中心解決方案，PEGAVERSE 數位雙生 AI 平台助力營運流程智慧更優化。

技鋼科技股份有限公司

攤位號碼 K0802

GIGABYTE

電話 +886-2-89126699 官網 www.gigabyte.com/Enterprise

GIGAPOD (DLC 解決方案)：專為大型語言模型訓練與推論設計的高密度伺服器，採直接液體冷卻，有效帶走 CPU、GPU 熱量，提升效能與系統穩定性。NVIDIA GB300 NVL72：NVIDIA 預計今年中推出的新一代 AI 機櫃系統，支援生成式 AI 和高效能運算對更高效能與大記憶體頻寬的需求。

宜鼎國際股份有限公司

攤位號碼 J0118

innodisk

電話 +886-2-77033000

官網 www.innodisk.com

宜鼎國際積極布局 AI 事業，2025 年 Computex 將聚焦展現 Innodisk AI 軟硬體整合實力。透過 Innodisk AI 全系列產品組合，滿足工控市場、邊緣 AI 至企業級伺服器之應用所需，實現 AI 時代下的高運算與高效能需求。

Complex Problems, Cool Solutions

複雜問題，冷靜解決

與 CPC 一同開啟更聰明的冷卻方式



COMPUTEX 展位號：TaiNEX2・4 樓 R1226 展位

由世紀自動化代理



UQD04/UQD06：專為 OCP 互通性設計的新一代液冷快接頭

UQD04/UQD06 系列旨在滿足您所需的流量，為最新及未來的晶片技術提供支持。

- 專利閥門設計，在斷開時也能確保極高可靠性，防止液體泄漏
- 卓越品質經過嚴格測試，包括 100% 氮氣泄漏檢測
- 提供熱銷款盲插設計



LQ 彎頭：緊湊 + 高流量，專為超大規模資料中心設計

當空間效率至關重要時，LQ 彎頭的可靠性已在全球領先的超級電腦和 AI 超級叢集中得到了驗證。

- 在極小空間內實現高流量
- 專為超大規模資料中心的機櫃內或機架歧管軟管佈線設計



LQS 系列：具有長期可靠性的不鏽鋼液冷接頭

當尺寸與流量比至關重要時，不鏽鋼材質的 LQS 系列是工程師追求耐用性和可靠性的首選產品。

- 材料具有天然抗腐蝕性
- 比 UQD 短 18%，適合狹窄緊湊的空間
- 提供多種流量尺寸與終端選項，包括盲插和手動連接

EZCast × COMPUTEX TAIPEI

Break Barriers and Display Freely with EZCast

Visit the EZCast booth and get a free sample!



Booth
Q1323

May 20-23, 2025
Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2, 1st Floor



Find Out More

明緯企業股份有限公司

攤位號碼 K0515a



電話 +886-2-22996100

官網 www.meanwell.com

AI 運算與 ESG 能源轉型趨勢，導致市場對高效能、小型化電源解決方案的需求日益迫切。在今年 COMPUTEX 2025 中，明緯展出的小體積、高效能產品，搭配「多產業並進 ×One-Stop-Shopping 一站式購足」策略，將可完整滿足市場對 AI 與 ESG 的電力供應需求。

施耐德電機股份有限公司

攤位號碼 M0802



電話 +886-2-66111000

官網 www.se.com

施耐德電機以「Grid to Chip, Chip to Chiller」為主軸，展示 AI 資料中心從設計到運維的全生命週期解決方案。展出中低壓盤櫃、不斷電系統、Busway、PDU，到氣冷、水冷與液冷產品，並結合 ETAP、AVEVA、EcoStruxure、CFD、DCIM 等數位平台，打造整合電力、冷卻與資料的智慧基礎架構。

智微科技股份有限公司

攤位號碼台北六福萬怡酒店 9 樓



JMicron

電話 +886-3-5797389

官網 www.jmicron.com

- JMS591(USB 3.2 Gen2 x2 & eSATA 6Gb/s to 5 ports SATA 6Gb/s) 多盤位硬體 RAID 解決方案

- JMB595 (PCIe Gen4x4 to 16 ports SATA 6Gb/s) 多盤位存儲解決方案原型

- 智能偵測解決方案

臺灣發展軟體科技股份有限公司

攤位號碼 I-1111/ L-0425



電話 +886-2-87978337

官網 www.skymizer.com

Skymizer 全新 LPU 加速 IP【HyperThought】，在效能、功耗與成本上對比 GPU 具顯著優勢，支援多模態與 Agentic AI，LISA v3.0 能同時載入與執行多模型。HyperThought 加速 IP 能幫助開發者輕鬆將現有應用移植至 HyperThought SoC 平台，推動 AI 推論技術普及化。HyperThought – Build your own AI chip with our IP.

威鋒電子股份有限公司

攤位號碼 N0313



VIA Labs, Inc.

電話 +886-2-22181838

官網 www.via-labs.com

USB4、SuperSpeed USB、USB PD 和顯示器控制晶片之領導廠商威鋒電子將介紹最新的 USB4、USB-C 與 DisplayPort 產品、工業級 Hub，展示遊戲專用 USB4 擴充底座示範設計、Smart KVM 概念、支援雙 4K120Hz 輸出的 USB4 擴充底座等產品。

博帝科技股份有限公司

攤位號碼 J1010



電話 +886-2-82280333

官網 www.patriotmemory.com

Patriot 博帝集團旗下擁有三大品牌，分別對應不同市場定位。Patriot 提供消費級記憶體與儲存產品；Viper Gaming 專為遊戲玩家打造高效能超頻記憶體與電競周邊；ACPI 則聚焦工業應用與嵌入式系統，提供穩定可靠的儲存解決方案，展現集團多元布局與技術實力。

綠億科技股份有限公司

攤位號碼 J1433



電話 +886-2-3501-8700

官網 www.lynwave.com

Lynwave 深耕網通 15 年，今年於 COMPUTEX 2025 呼應「NEXT AI」主題，將展出核心產品 ATM 與前瞻 Wifi 8 Smart Antenna 概念機，強化智慧監控、製造、倉儲等應用效能。台灣研發、中國及越南自有產線，打造具韌性的跨國供應鏈，並積極推進 RBA 認證，攜手客戶實踐 ESG。

慧榮科技股份有限公司

攤位號碼 G0001



SiliconMotion

電話 +886-2-2219-6688

官網 www.siliconmotion.com

慧榮科技是 NAND Flash 控制晶片領導者，提供從雲端到邊緣完整的儲存解決方案，滿足 AI 時代對高效能與低功耗儲存的迫切需求。展出亮點包括 SM2504XT 與 SM2508 PCIe Gen5 消費級 SSD 控制晶片、SM2324 USB4 可攜式 SSD 控制晶片、MonTitan® PCIe Gen5 企業級 SSD 開發平台及車載與嵌入式儲存解決方案。

澜起科技股份有限公司



電話 +86-21-54679038

官網 www.montage-tech.com

瀾起科技成立於 2004 年，是國際領先的資料處理及互連晶片設計公司，致力於為雲計算和人工智慧領域提供高性能、低功耗的晶片解決方案。公司互連類晶片主要有 PCIe Retimer，CXL MXC 和時鐘晶片等。

台灣亞馬遜網路服務有限公司




官網 aws.amazon.com/tw/

Amazon Web Services (AWS) 是全球最全面、最廣泛採納的雲端服務，透過全球資料中心提供超過 200 項功能完整的服務。數百萬個客戶，包括成長最快的新創公司、最大型企業以及領先的政府機構，都使用 AWS 來降低成本、變得更靈活，且更迅速地創新。

研華股份有限公司

攤位號碼 P0413a、K0605



電話 +886-2-77323399

官網 www.advantech.com

研華以邊緣運算與邊緣 AI 為核心，展示零售、物流、營運、自助服務至數據分析與管理的未來應用，聚焦智慧服務產業轉型，協助業者提升管理效率與競爭力，以 AI 應用 (包含影像 AI 分析與生成式 AI) 打造全新的個人化消費體驗。

DEEPX

攤位號碼 L0409



電話

官網 deepx.ai

人工智慧半導體領域的領導者 DEEPX 與台灣企業合作，加速智慧工廠、機器人、智慧城市和人工智慧伺服器。透過利用邊緣人工智慧和智慧自動化，DEEPX 提高了效率，促進了產品永續性，並推動了各行各業的創新——塑造一個更智能化、更互聯的未來。

趨勢科技股份有限公司

攤位號碼 N0114



電話 +886-2-2378-9666

官網 www.trendmicro.com

Proactive security starts here!

- Security for AI Blueprint: Safeguarding Your AI Investments
- Inside the Mind of the Adversary: Simulating Cyber Attacks with Your Digital Twin
- Secure Your AI Factory: Full Control Meets Built-In Protection

台灣恩智浦半導體股份有限公司



歡迎至 NXP 技術夥伴攤位參觀

(P0413a、K0605、I0607a、I0617a、L0118、N0814(TADA)、G0017、K0515a、L0106、P0425a、L0617a)

電話 +886-2-8170-9999

官網 www.nxp.com

恩智浦擁有豐沛的技術創新能量驅動邊緣 AI，加速人工智慧和機器學習的進步，讓具有感知、思考、具有互聯功能的設備裝置們展開行動，並與非常完整的功能安全、資訊安全和最新的軟體定義開發相結合

安費諾

攤位號碼 I 1317



電話 +886-3-378-6960

官網 www.amphenol-cs.com

Amphenol 於 COMPUTEX 2025 重磅呈現「The Body of AI」展區，將由旗下 13 個核心事業部聯合展出全方位連接器產品，呈現高速背板、I/O 介面、光纖連接、液體冷卻等解決方案，推動 AI 運算革命，打造完整解決方案。為您的下一代 AI 資料中心提供全面性支援。

泓格科技股份有限公司

攤位號碼 K0415



電話 +886-3-5973366

官網 www.icpdas.com

- 智慧節能減碳解決方案
- 工業級設備聯網與多主存取技術





2025年5月20日-23日
南港展覽館一、二館

 COMPUTEX 主題演講

 COMPUTEX 論壇

 Tech'em High

 Green Impact Label

 主題導覽

 新創競賽

COMPUTEX
2026年6月2日-5日
回歸
世貿展覽館

www.COMPUTEXTaipei.com.tw
www.InnoVEX.com.tw

Organizers:  TAITRA  TCA



多元整合行銷服務

影音廣宣服務

引爆品牌聲量，
帶領議題風向，
創造品牌高影響力

數位廣告服務

專業內容策動議題影響力，
發展長期效益

活動行銷服務

整合線上線下，
滿足各式專案需求，
無痛掌握新媒體內容



行銷聯繫



中文網展會專區

COMPUTEX 科技趨勢論壇 連結天際引領航程 5G 賦能航太新紀元

5.21 台北南山藝文中心

產研專家準時開講

蔣村杰
工研院資通所副所長

邱展鴻
漢翔航空工業執行長

楊純福
華電聯網資訊系統
整合處協理

蘇俊吉
義傳科技總經理特助

熱門議題速覽



下世代通訊發展與多層次通訊架構
結合雲端運算、邊緣AI、衛星通訊、感測技術，為企業與產業界提供5G-A與6G時代的發展方向與商業機會。



衛星通訊市場機遇與產業生態合作
衛星通訊如何結合NTN，提升全球通訊覆蓋能力，賦能智慧製造、智慧交通、國防安全等關鍵領域。



無人機產業鏈的未來趨勢與創新
從硬體製造、軟體開發到法規政策的深度探討，以及在商業、軍事、農業、物流等領域的應用服務與創新。



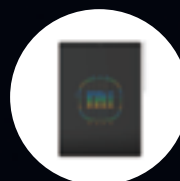
通訊技術與AI深度融合
AI x ML加持，實現更靈活的專網應用，滿足企業級市場需求，推動數位轉型進程。

報名成功且出席活動，享多重好禮！



問卷禮

設計款杯墊
填就送，送完為止



勤學禮

小米手寫板/2名
活動結束抽出，得
獎人須在場、不得
代領，恕不挑色

太空×空中×地面一體化
開啟全球無縫連網新紀元



立即報名

GEN AI 翻轉世界

COMPUTEX 科技趨勢論壇 從製造到創造AI生成的產業未來

05.22 台北
南山藝文中心

從矽島到智慧島，台灣的新藍圖

「全球每 10 台 AI 伺服器，9 台來自台灣！」在生成式 AI (GenAI) 浪潮中，台灣不僅是供應鏈的霸主，更將蛻變為全球創新的智慧引擎！晶片、雲端、製造、醫療、智慧生活 從「矽島」到「智慧島」我們正以 GenAI 重塑遊戲規則——這是屬於台灣的生成革命！

從製造到創造，GenAI 翻轉產業

「製造」的硬實力，正透過 GenAI 進化為「創造」的影響力。COMPUTEX 2025，DIGITIMES 結合國內外大廠舉辦「GenAI 創新應用論壇」。您的參與，決定台灣能否從供應鏈的執行者，躍升為價值鏈的定義者！

期待您的蒞臨參與



5/22 (四)
台北南山藝文中心
台北市信義區松仁路 100 號 3 樓

- | | |
|-------|--|
| 09:00 | 生成式 AI 影像技術的創新應用
鴻海研究院 |
| 09:30 | 多模態生成革命：文字、圖像、程式碼協作
台灣微軟 |
| 09:50 | 生成式 AI 的安全與倫理
UL Solutions |
| 10:10 | 混合多雲架構 × GenAI 潛能釋放
Broadcom |
| 11:00 | AI 製造升級新解方
緯謙 |
| 11:20 | 永續 AI：如何平衡算力與節能？
Lenovo |
| 11:40 | 邊緣平台如何加速 AI 應用落地
凌華科技 |
| 13:30 | GenAI 應用與政策關鍵洞察
DIGITIMES 研究中心 |
| 14:00 | GenAI 驅動的下一代應用革命 TBC
愛卡拉 |
| 14:20 | Garmin AI 串聯智慧生活
Garmin TBC |
| 15:30 | Panel 對談：AI 產品與服務如何 go to market ?
台大智活中心主持 |

俯瞰 你與川普、AI、半導體，形成的風暴圈

天選·矽島 川普風暴下的科技島

★ 半導體50年的傳奇揭密 ★

AI浪潮來襲、川普風暴顛覆秩序之際，144公里寬的台灣卻成為全球戰略核心。
本書剖析半導體產業競逐，揭示台灣如何在國際角力中撐起全球供應鏈。
突破重圍，台灣是世界關鍵！

重磅推薦

(按姓氏筆畫排列)

卞志祥 | 微軟台灣總經理
宋恭源 | 光寶集團創辦人
余日新 | 逢甲大學講座教授
李永然 | 永然聯合法律事務所所長
邵中和 | Zettabyte 董事長
侯永清 | 台灣半導體產業協會理事長

高健榮 | 啟碁總經理
章平達 | 蔡司台灣總經理
黃齊元 | 藍濤亞洲總裁
黃顯華 | 福邦證券金融集團董事長
曾崇凱 | 康寧中國區總裁
雲昌昱 | 安富利亞太區總裁

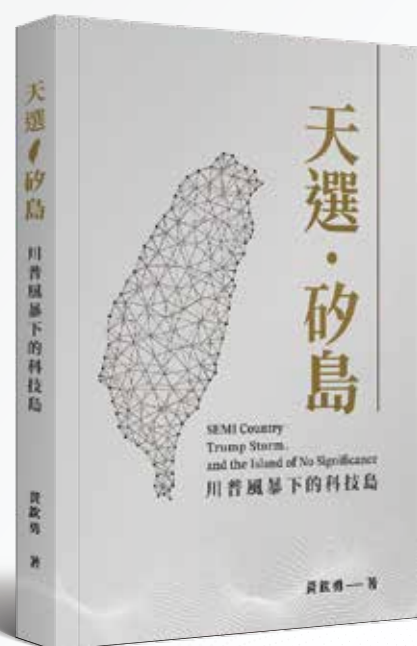
劉揚偉 | 鴻海董事長
鄭文宗 | 文晔董事長
謝宏亮 | 辛耘企業董事長
簡禎富 | 清華大學講座教授



立即購買

SEMI Country

Trump Storm,
and the Island of No Significance



作者 —— 黃欽勇

GIGABYTE™

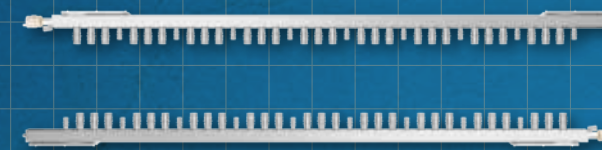
NVIDIA

GIGAPOD

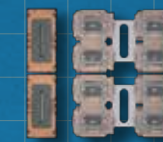
Next-gen AI power in a liquid-cooled rack-scale solution.



Manifold Distributes coolant evenly across all nodes.



PIPE
Connects components and circulates coolant efficiently.



Coldplate
Efficiently absorbs heat directly from CPUs and GPUs.



PSU
Delivers stable power and supports high-density compute.



G4L3-ZD1
4U DP DLC AI Server
NVIDIA HGX™ H200
AMD EPYC™ 9005



R284-S93
2U DP Management Server
Intel® Xeon® 6 Processors
2 x FHFL PCIe Gen5 Slots



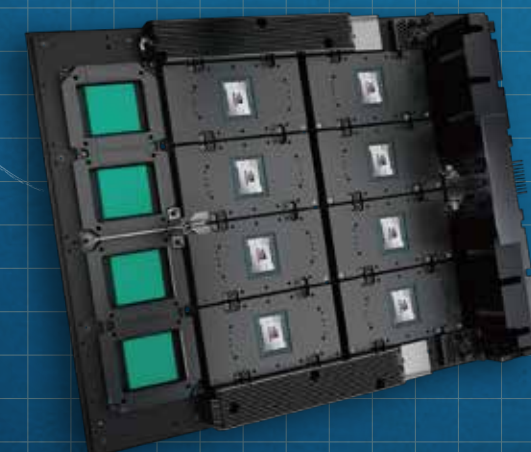
G4L3-SD1
4U DP DLC AI Server
NVIDIA HGX™ H200
5th Gen Intel® Xeon® Scalable



S183-SH0
1U DP Storage Server
5th Gen Intel® Xeon® Scalable
32-Bay E1.S NVMe

NVIDIA HGX™ H200

The NVIDIA HGX™ H200 combines NVIDIA H200 GPUs with high-speed interconnects to deliver extraordinary performance, scalability, and security for every data center.



AN EIGHT-WAY HGX H200 PROVIDES OVER 1.1 PETAFLOPS OF FP8 DEEP LEARNING COMPUTE AND 11TB OF AGGREGATE HIGH-BANDWIDTH MEMORY.



Into A New Tomorrow | Booth K0802